株式会社 アルバック

2025年6月期　決算説明資料

連結決算概要および業績予想
新中長期経営計画（Value Up Plan）

2025年8月13日

将来見通し等に関する記述についての注意事項

- **将来見通しについて**
  本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
- **数字の処理について**
  本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。
- **品目名称変更について**
  2025年6月期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

ULVAC

サマリー

2025年6月期連結業績概要

- 売上高・各利益項目は概ね前回予想通りの着地、**売上総利益率 31.8%は上場来最高水準**
- 株主還元重視による安定配当の観点から、**配当は従来予想 164円を据え置き（過去最高）**

2026年6月期業績予想

- 受注回復基調。売上高は事業改革に伴う減少があるものの、半導体電子を中心とした売上高増加等により、前年並みの高水準を維持する見込み
- 各利益項目は着実に改善を見込む

新中長期経営計画（バリューアッププラン）

- 経営資源を最適化し、半導体電子中心の事業ポートフォリオを見直すことで、持続的な高成長・高収益性を確実に実現するため、**抜本的な改革を断行**

2026年6月期を初年度とする**新中長期経営計画 “バリューアッププラン”** をスタート

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

2025年6月期　業績概要

2026年6月期　業績予想

新中長期経営計画～ Value Up Plan～

- 事業改革
- 成長戦略
- 生産改革
- 資本政策

2025年6月期 連結業績概要

» 売上高・各利益項目は概ね前回予想通りの着地、売上総利益率 31.8%は上場来最高水準
» 25/6期配当金164円は過去最高

【単位：億円】	24/6期	25/6期	前期比		25/6期 前回予想	前回予想比
			増減額	増減率		増減率
受注高	2,582	2,256	-326	-13%	2,300	-2%
売上高	2,611	2,512	-99	-4%	2,500	+0%
売上総利益	807	799	-8	-1%	800	-0%
率	30.9%	31.8%	+0.9pt	-	32.0%	-
販管費	509	533	+24	+5%	530	+1%
営業利益	298	265	-32	-11%	270	-2%
率	11.4%	10.6%	-0.8pt	-	10.8%	-
経常利益	298	286	-12	-4%	275	+4%
率	11.4%	11.4%	+0.0pt	-	11.0%	-
親会社株主に帰属する当期純利益	202	167	-35	-18%	170	-2%
率	7.7%	6.6%	-1.1pt	-	6.8%	-
1株あたり配当金（円）	144	164			164	

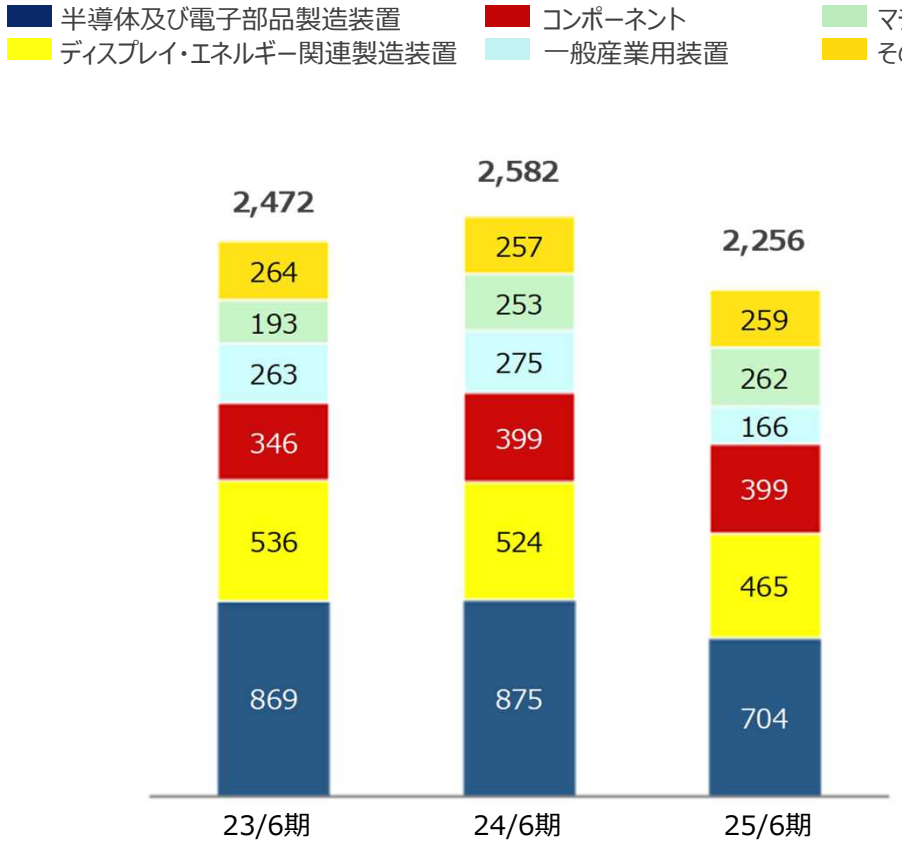
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

受注高・売上高実績

» 受注高：パワーデバイス・バッテリービジネス等の投資減速により前期比減少
» 売上高：高水準の受注残高の寄与等により、上場来2番目に高い水準で着地

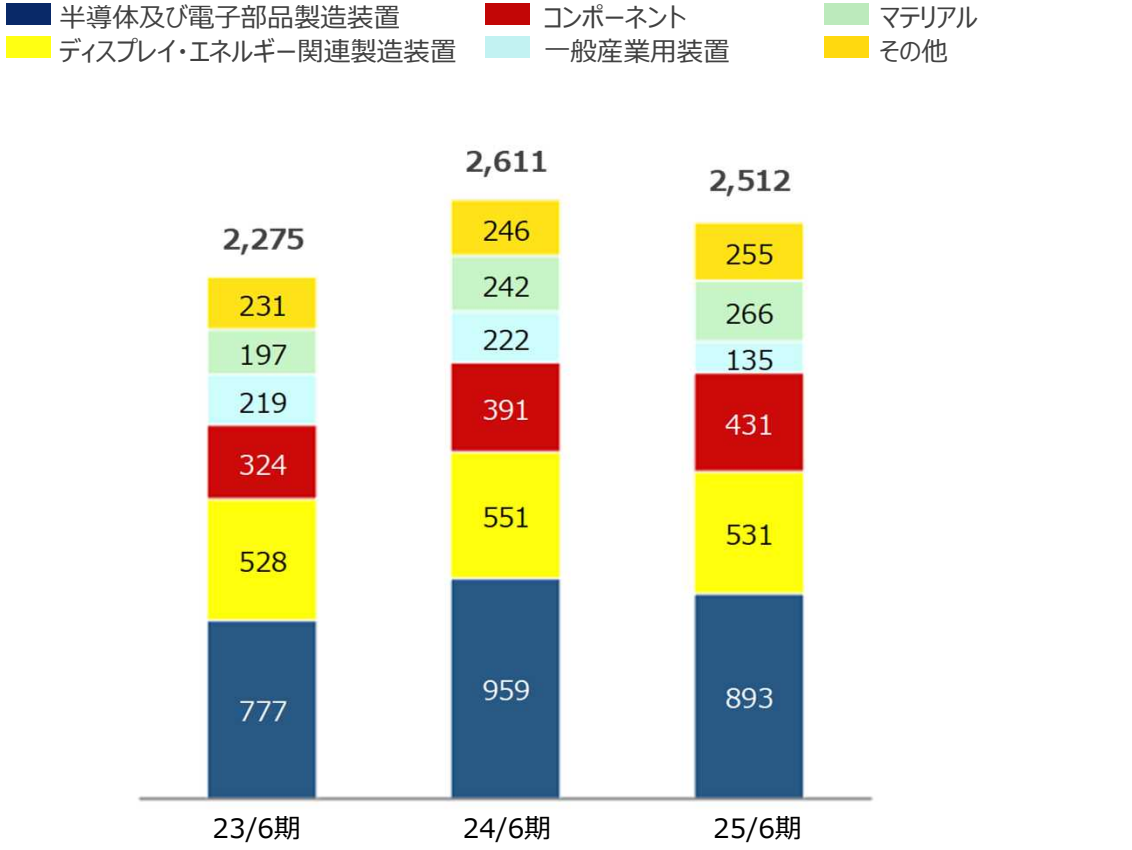
受注高

【単位：億円】



売上高

【単位：億円】

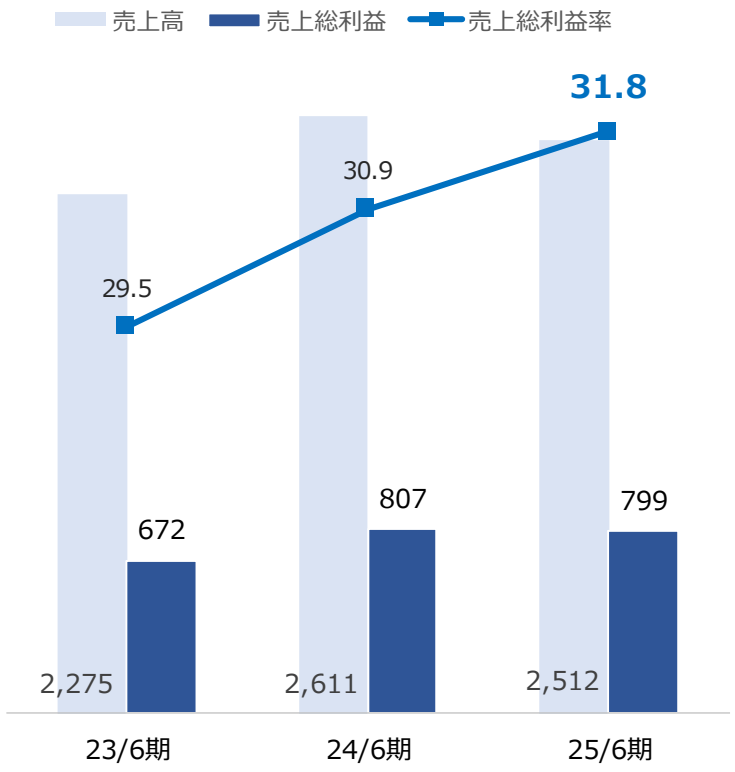


Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

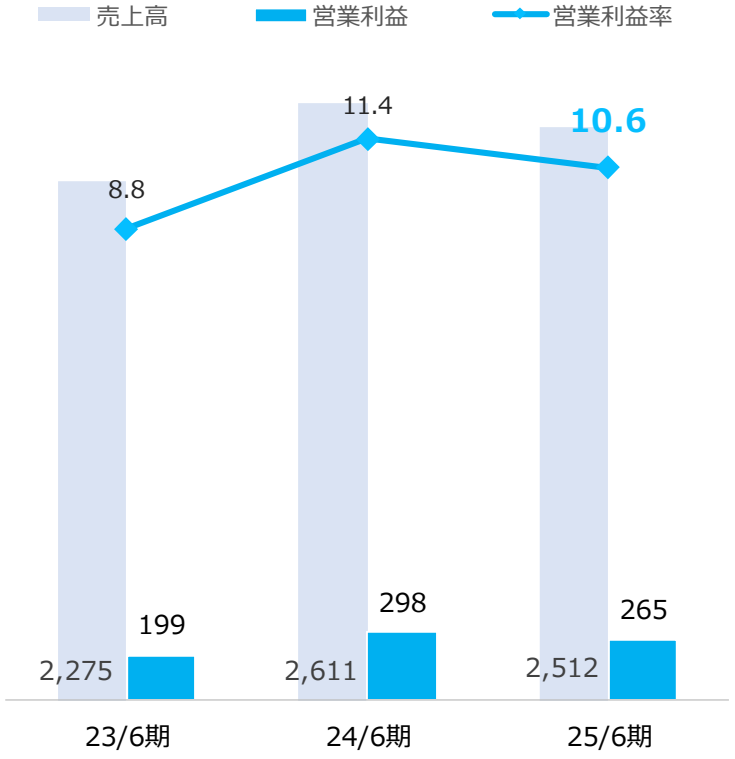
利益率推移

» 売上総利益率：ミックス改善や高利益率案件の寄与により、31.8%と上場来最高水準を達成
» 営業利益率：売上高減少および研究開発費等の増加により、前期比で営業利益率が低下

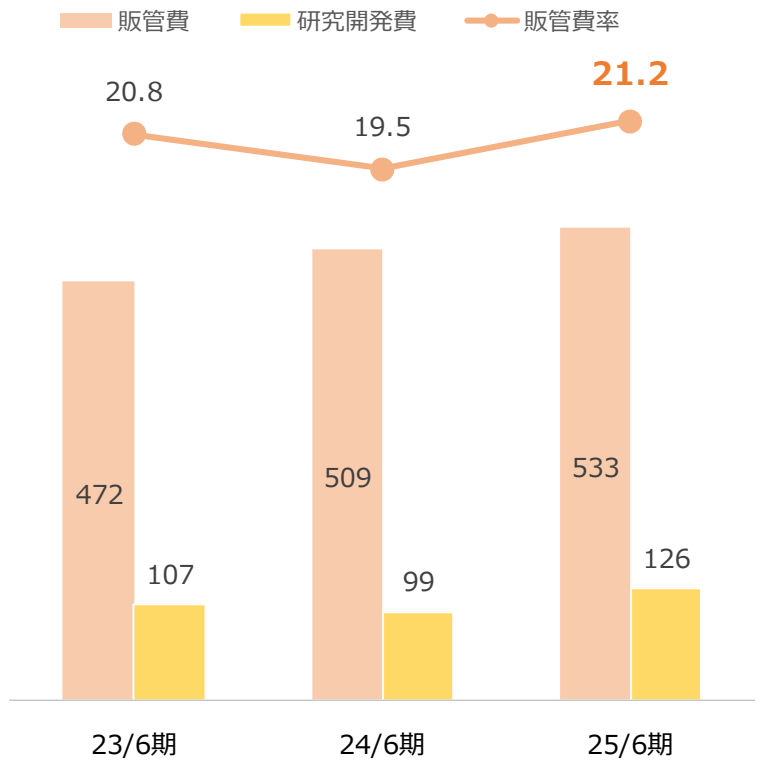
売上総利益率 【単位：億円、%】



営業利益率 【単位：億円、%】



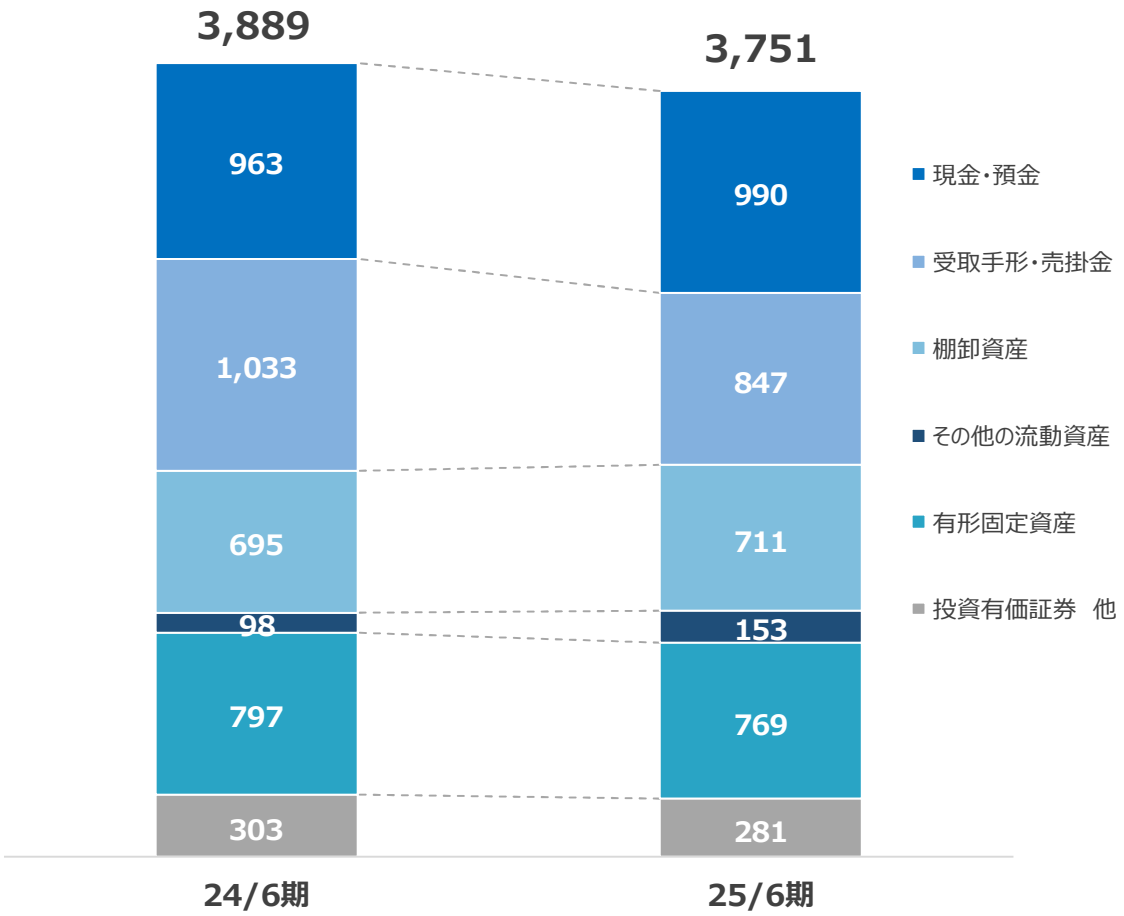
販管費率 【単位：億円、%】



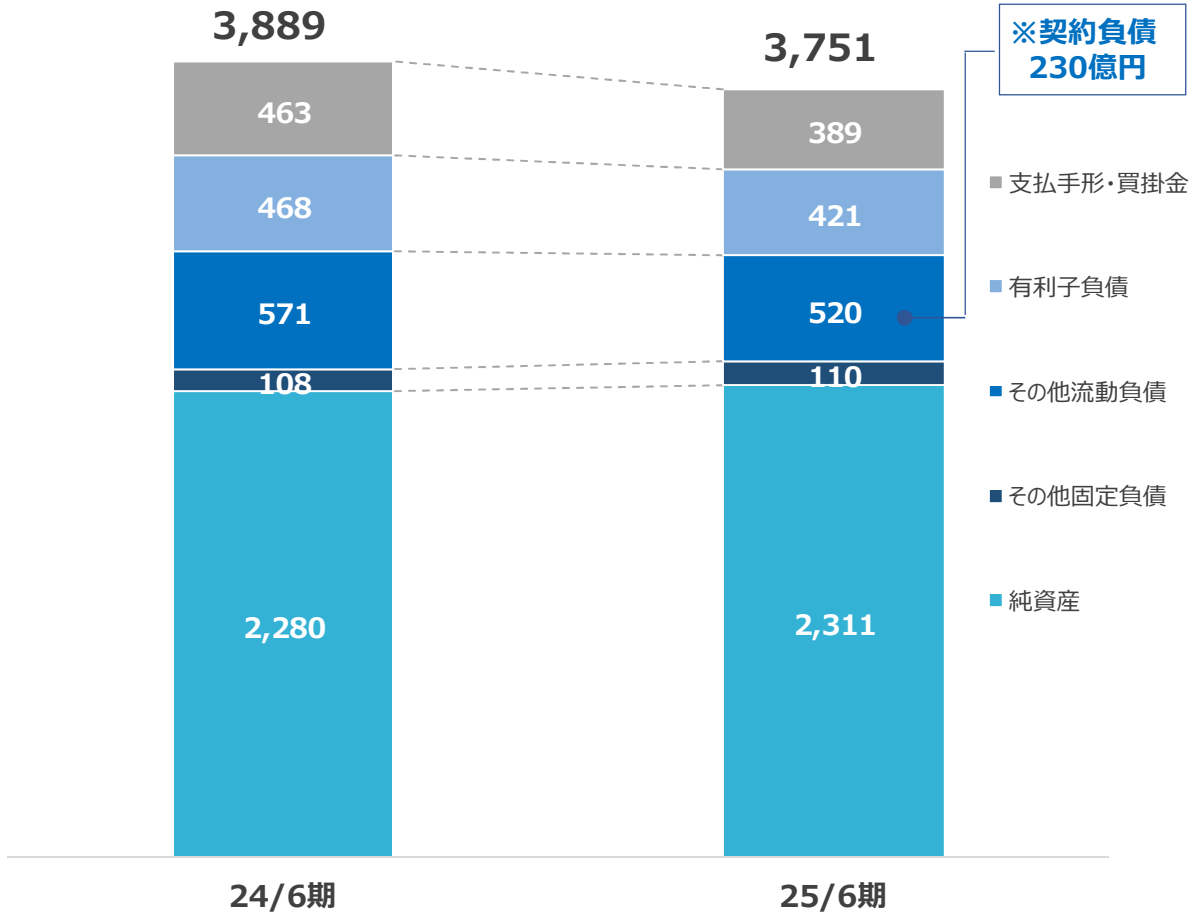
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

貸借対照表

資産 【単位：億円】



負債・純資産 【単位：億円】



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

2025年6月期　業績概要

2026年6月期　業績予想

新中長期経営計画～ Value Up Plan～

- 事業改革
- 成長戦略
- 生産改革
- 資本政策

2026年6月期　業績予想

» 受注高：半導体関連の継続投資やパワーデバイスの投資回復等により、受注は回復基調
» 売上高・各利益(率)：受注回復、製造L/T*短縮等により売上高は高水準で推移。各利益（率）は着実に改善を見込む

【単位：億円】	25/6期	26/6期			前期比	
		上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率
受注高	2,256	1,200	1,300	2,500	+244	+11%
売上高	2,512	1,155	1,345	2,500	-12	-0%
売上総利益	799	355	470	825	+26	+3%
率	31.8%	30.7%	34.9%	33.0%	+1.2pt	-
営業利益	265	90	195	285	+20	+7%
率	10.6%	7.8%	14.5%	11.4%	+0.8pt	-
経常利益	286	90	195	285	-1	-0%
率	11.4%	7.8%	14.5%	11.4%	0.0pt	-
親会社株主に帰属する当期純利益	167	65	135	200	+33	+20%
率	6.6%	5.6%	10.0%	8.0%	+1.4pt	-

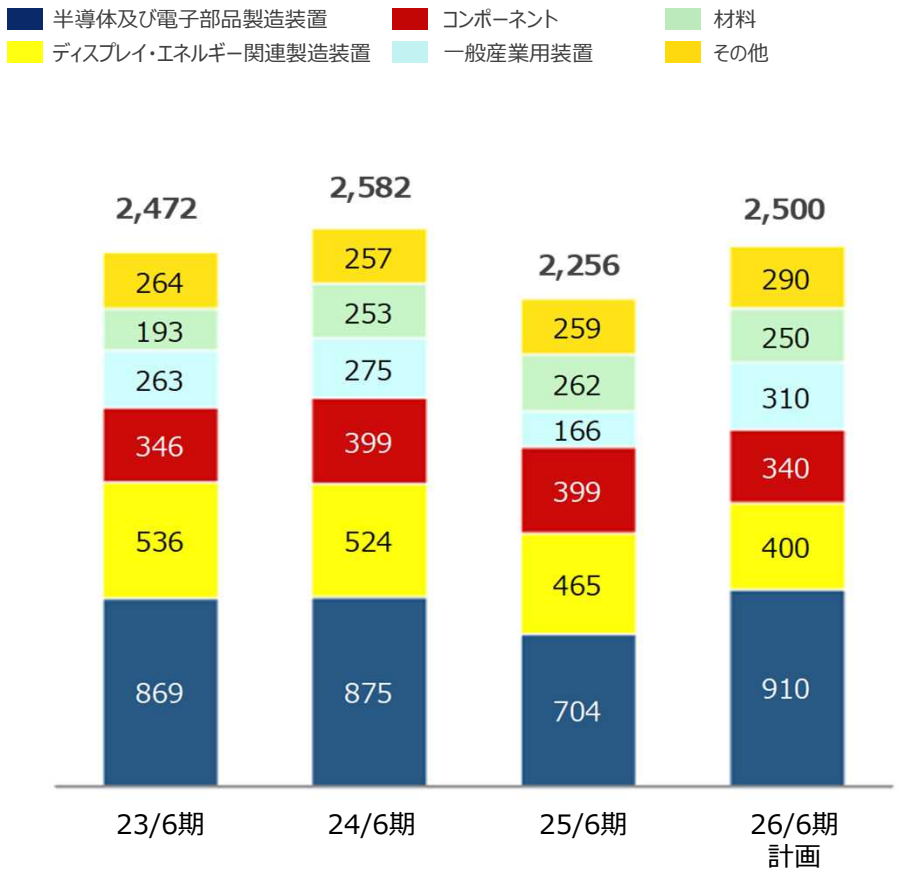
＊ L/T：Lead Time

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

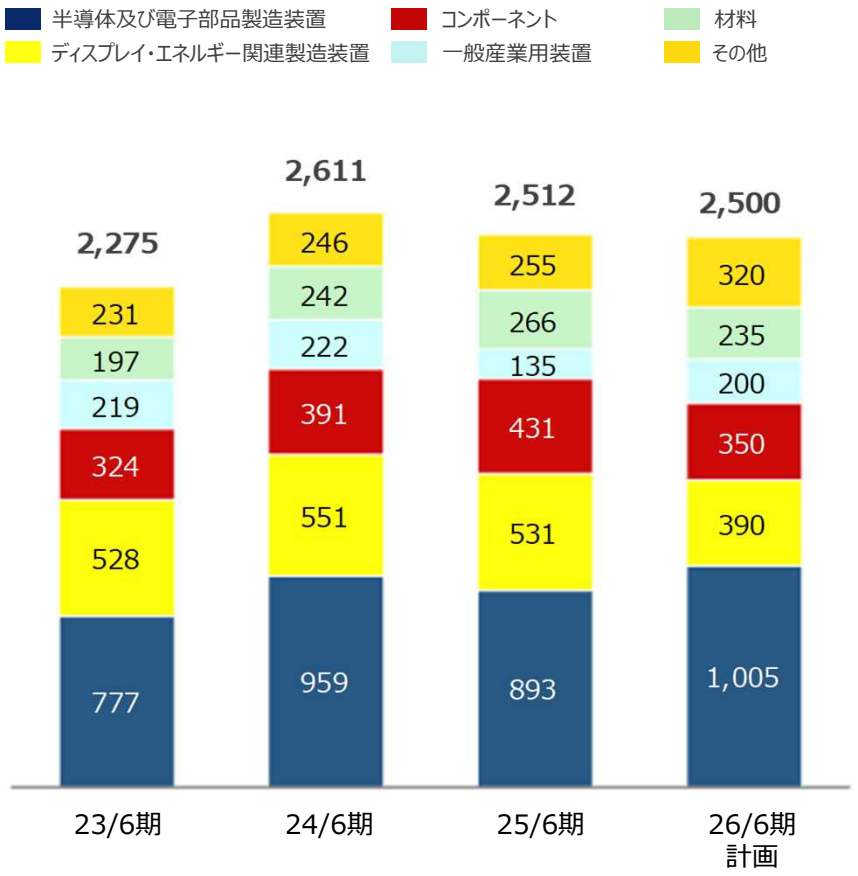
2026年6月期　受注高・売上高計画

» 受注高：半導体関連の継続投資やパワーデバイスの投資回復により、受注は回復基調
» 売上高：受注回復、製造L/T短縮等により、売上高は高水準で推移

受注高 【単位：億円】



売上高 【単位：億円】



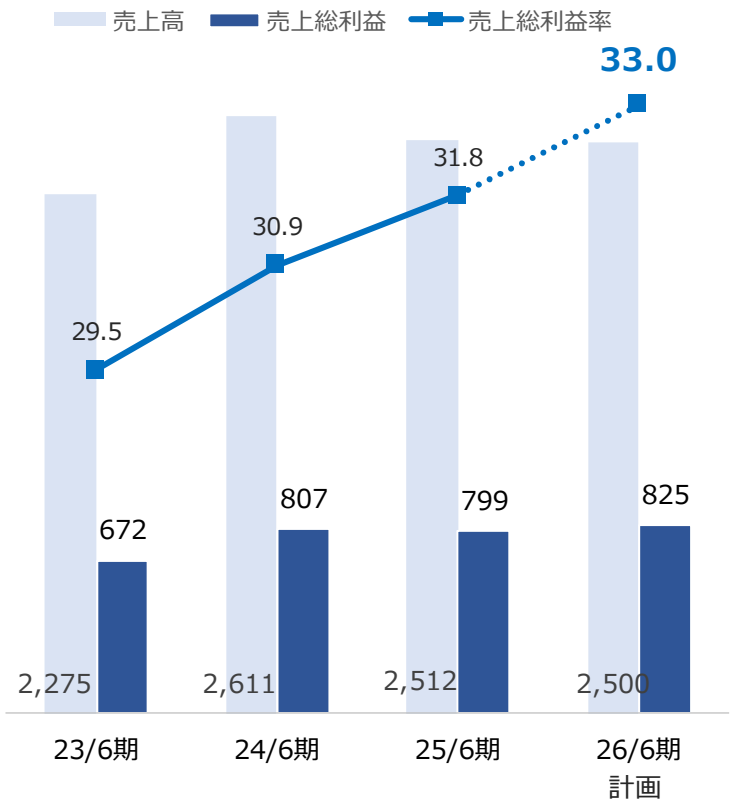
※　26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

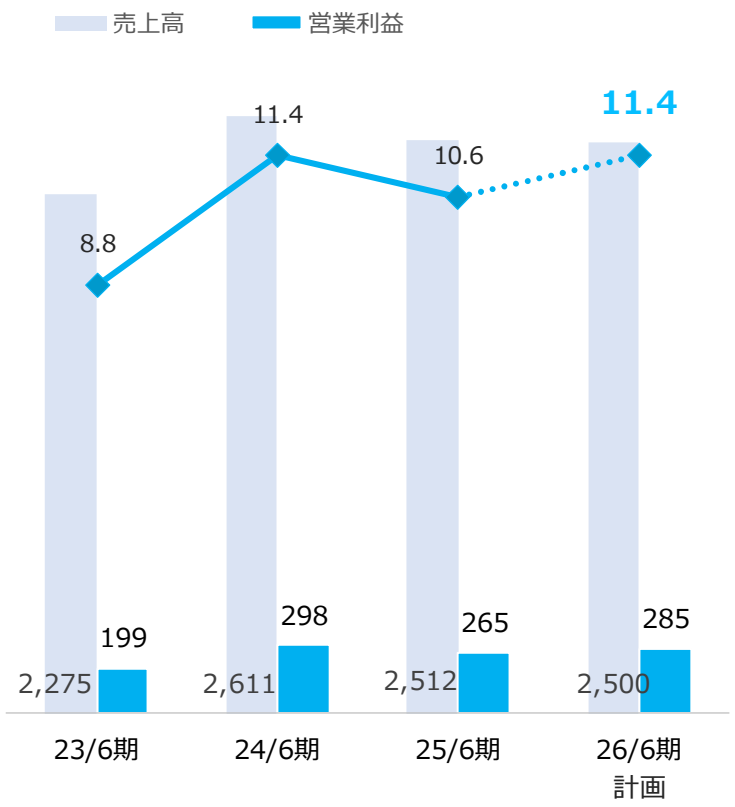
2026年6月期　利益率計画

» 売上総利益率：半導体電子の売上高増加に伴うミックス改善効果等により着実に改善を見込む
» 営業利益率：売上総利益率改善等により、営業利益率改善の見込み

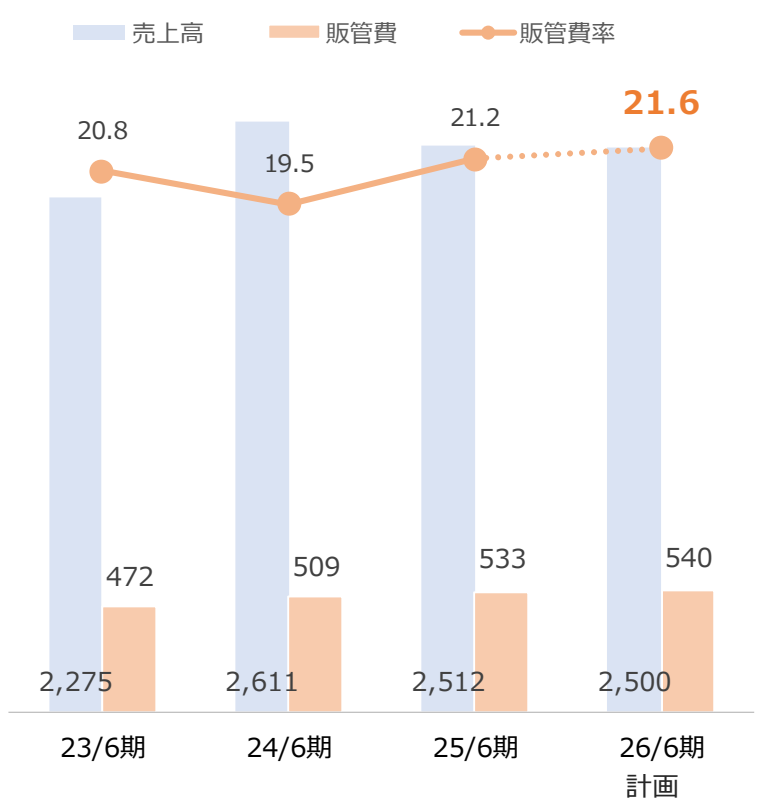
売上総利益率　【単位：億円、%】



営業利益率　【単位：億円、%】

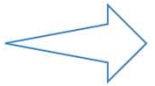


販管費率　【単位：億円、%】



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

市場環境・投資動向

品目	市場環境・投資動向	CY25～26
半導体 ロジック・メモリ	• DRAM：HBM関連投資継続・新規顧客投資寄与 • NAND：ストレージ需要・生成AI関連需要による拡大期待 • ロジック：次世代ノードに向けた投資本格化・MHM工程展開	
各種電子デバイス	• 生成AI向けWLPビジネス継続、PLP開発投資寄与 • AR/VR向け中国オプトデバイス投資貢献	
パワーデバイス	• 中国大手デバイスメーカー中心に8inchSiCの投資回復見通し	
ディスプレイ	• タブレット向けOLED実現に向けた設備追加・改造案件による持続的貢献	
バッテリー関連	• バッテリーメーカーによるアルミ両面蒸着膜の試用増加も、量産転換は依然鈍化。銅両面蒸着膜・リチウム膜等で中長期的な成長期待	
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	• 半導体電子等における各種設備投資の活発化に伴い、安定基盤ビジネスとして堅調に推移 • 先端デバイス等の研究開発活発化に伴う表面分析装置好調	

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

2025年6月期　業績概要

2026年6月期　業績予想

新中長期経営計画～ Value Up Plan～

- 事業改革
- 成長戦略
- 生産改革
- 資本政策

基本方針・目指す姿：新中長期経営計画 ～バリューアッププラン～

半導体電子中心の事業ポートフォリオの選択と集中

成長戦略

- 半導体電子への注力加速
- 事業間シナジーを活用した新たな半導体電子関連ビジネスの創出
- M＆A等を活用したビジネス拡大

約1,100億円UP

31/6期までの
連結売上高増加額

<31/6期 中長期財務目標>

営業利益 **790億円**

営業利益率 **22%**

事業改革 （２年間で完遂）

- 低採算事業等の縮小撤退
- グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化
- 人件費・販管費等の適正化による固定費削減

5.5% UP

28/6期までの
営業利益率改善

生産改革

- 生産拠点の生産効率UP
- モジュラーデザインによる収益性改善

12% UP

31/6期までの
対象装置事業における
営業利益率改善

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

中長期財務目標

項目	2025/6期 通期実績	**2028/6期 中間目標**	**2031/6期 目標**
売上高 （CAGR） 半導体電子関連ビジネス**	2,512億円	**2,600億円** （事業改革による縮小撤退考慮後）	**3,600億円 （CAGR 12%）*** （CAGR 17%）
半導体電子関連ビジネス 売上高構成比	36%	**45%**	**60%以上**
営業利益	265億円	**390億円**	**790億円**
営業利益率 半導体電子関連ビジネス	10.6% 11.6%	**15%** 19%	**22%** 25%
ROE	7.5%	**10%**	**16%**

*　事業改革後の想定売上高をベースに計算
** 管理会計に基づく数値　半導体電子事業及び関連事業

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

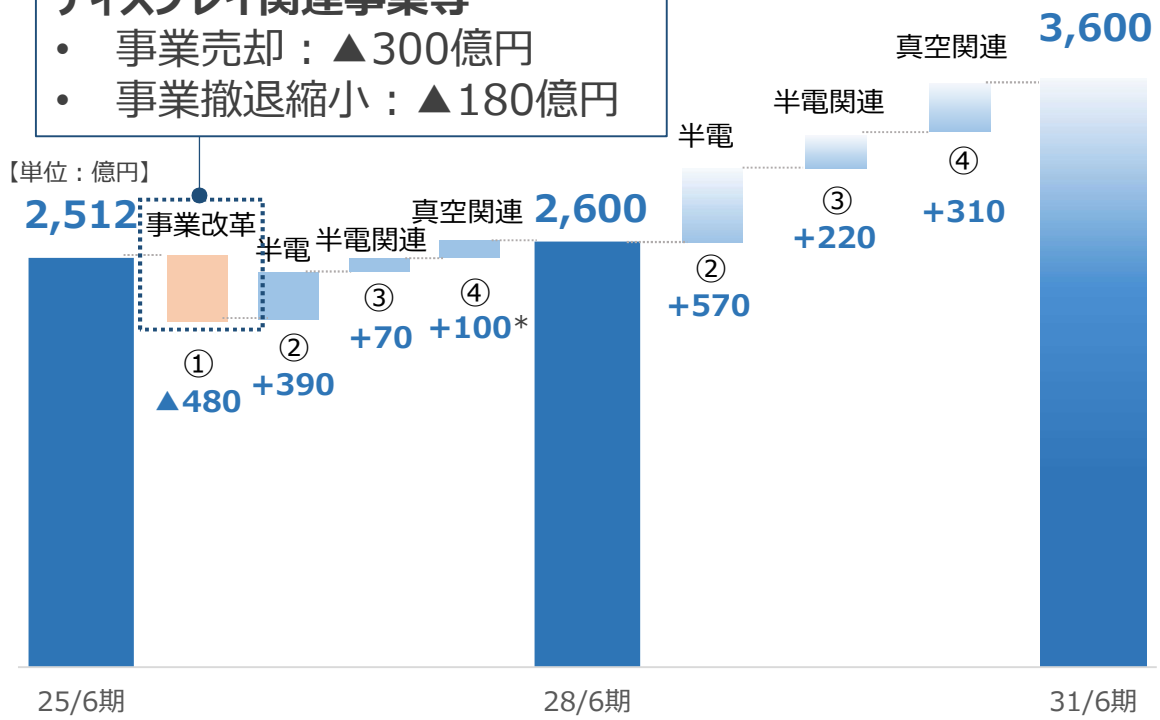
目標達成に向けた道筋

» 28/6期までに事業改革による売上高減少を上回る半導体電子事業等の成長を目指し、営業利益率の着実な改善を実現

売上高増減要因

① 低採算事業等の縮小撤退等による売上高減少
② 半導体電子ビジネスの売上高増加
③ 半導体電子関連ビジネスの売上高増加
④ 真空関連ビジネスの売上高増加

事業改革による売上高減少
ディスプレイ関連事業等
- 事業売却：▲300億円
- 事業撤退縮小：▲180億円

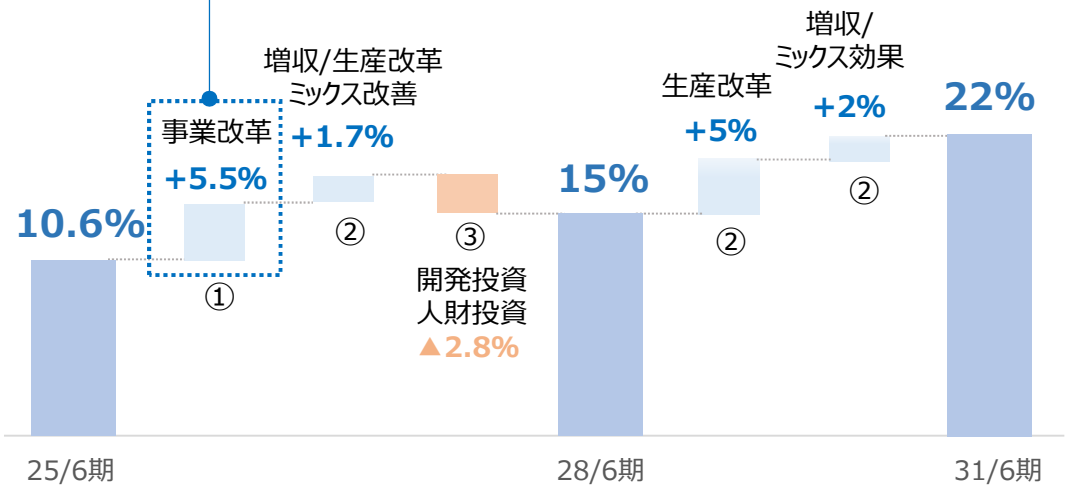


※半電/半電関連/真空関連の内訳は次ページ参照　＊ 1億円単位は切り捨て

営業利益率増減要因

① 事業改革による利益率改善
② 生産改革・ミックス改善・増収による営業利益増加
③ 28/6期以降の成長に向けた製品開発投資・人財投資等

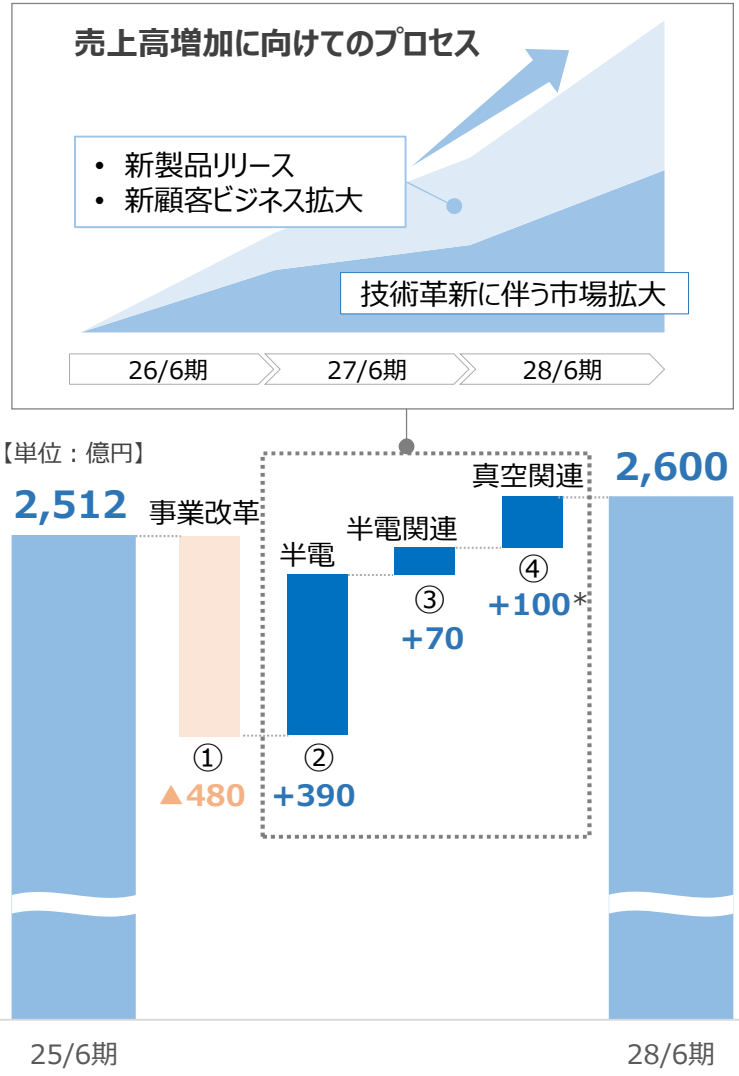
事業改革による利益率改善
- 低採算事業等の縮小撤退
- グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化
- 人件費・販管費等の適正化による固定費削減



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

28/6期にかけての売上高増加要因

» 既存ビジネスをベースに技術革新に伴う市場拡大と顧客技術ロードマップに連動した新製品リリースなどにより、事業改革に伴う売上高減少を上回る半導体電子事業等の成長を目指す



■ 28/6期にかけての売上高増加要因

② 半導体電子	+390億円
• メモリ	HBM関連投資活発化＋新顧客・新工程参入
• ロジック	ハードマスク工程展開＋金属膜工程参入
• パワーデバイス	8inchSiC投資本格化＋GaN投資開始
• 各種電子デバイス	パッケージングビジネス活況＋新顧客・新工程参入

③ 半導体電子関連	+70億円
• 表面分析装置	分析装置シェア堅持＋半導体検査装置ビジネス参入
• マテリアル(半導体)	半導体ビジネス活況＋競争優位製品で拡大

④ 真空関連	+100億円*
• コンポーネント	半導体電子市場向け新製品リリースによるビジネス拡大
• バッテリー等	リチウム電池の安全性向上へ両面蒸着膜採用進展
• リークテスト	データセンター向け冷却システム等、多用途展開拡大

＊ 1億円単位は切り捨て

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

2025年6月期　業績概要

2026年6月期　業績予想

新中長期経営計画～ Value Up Plan～

- 事業改革
- 成長戦略
- 生産改革
- 資本政策

事業改革の方針

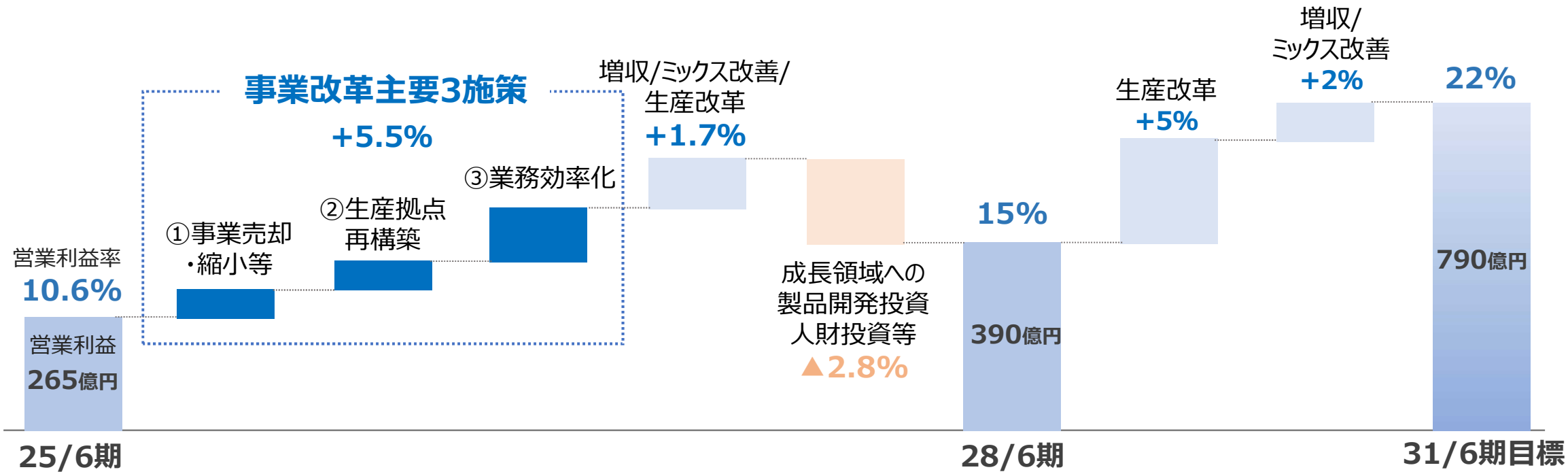
経営資源の最適化を断行

- 低採算事業等の縮小撤退
- グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化
- 人件費・販管費等の適正化による固定費削減

27/6期までの2年間で経営資源の最適化施策を完遂
28/6期初からの収益率寄与を想定

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

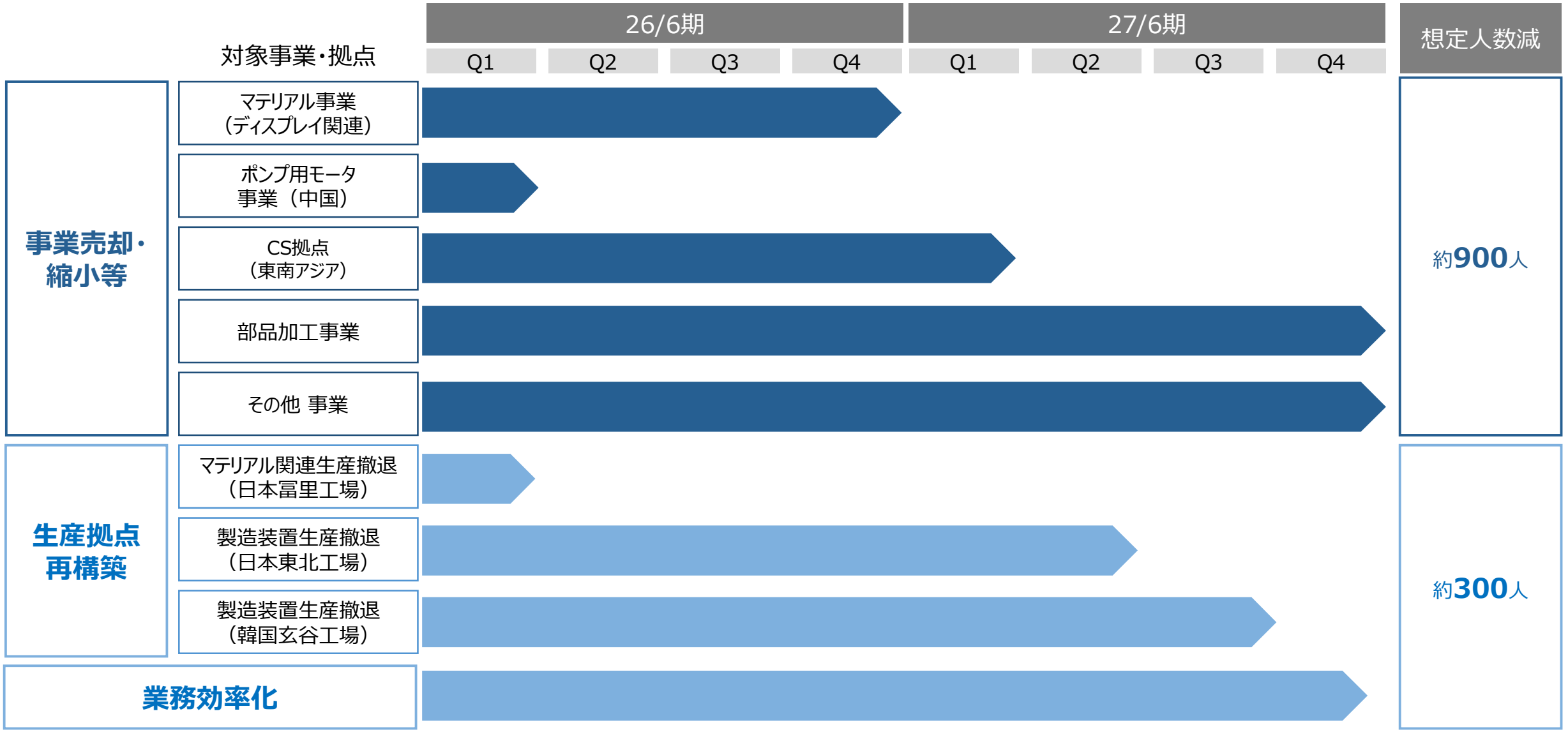
目標達成に向けた道筋（営業利益率増減要因）



	主要3施策	内容
事業改革	① 事業売却・縮小等	持分譲渡による非連結化を含み6事業の売却・縮小等
	② 生産拠点再構築	工場縮小（１拠点）、工場内一部事業の生産縮小後、他事業転用（2拠点）
	③ 業務効率化	業務・機能の統合等による業務効率化
生産改革		MD化による調達・部品共通化による変動費削減、設計・製造効率向上と拠点集約による固定費削減
成長領域への投資		成長領域（半導体電子等）への製品開発投資・人財投資等

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

事業改革のロードマップ



※アルバック・テクノ株式会社、タイゴールド株式会社は2025年7月1日に合併済み

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

事業改革のインパクト

» 経営資源の最適化等により、28年6期における営業利益の改善効果として120億円（2025年6月期比）を見込む

目標・効果

人員減

1,200人
（6,200人→5,000人）

連結子会社減少

8社
（29社→21社）

営業利益改善額

120億円

※25年6月期から28年6月期までの連結業績の改善額

その他PL影響

一時的な費用は特別損益として計上されるものの、事業売却益等もあり、影響は限定的

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

2025年6月期　業績概要

2026年6月期　業績予想

新中長期経営計画～ Value Up Plan～

- 事業改革
- 成長戦略
- **生産改革**
- 資本政策

生産改革の方針

モジュラーデザイン（MD）推進強化

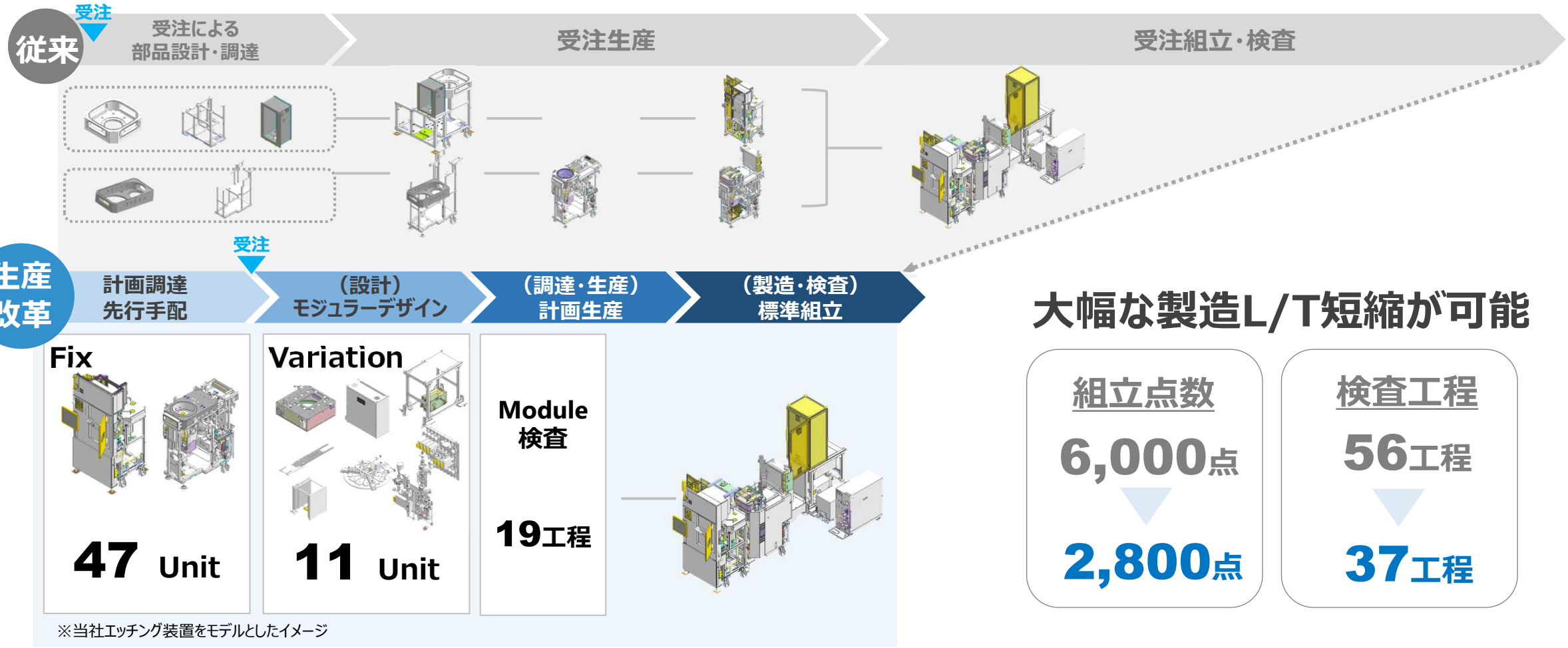
- MD化によるVolume調達及び部品共通化⇒ 変動費削減
- MD化による設計・製造効率の向上とリードタイム短縮、製造拠点の集約による生産効率向上⇒ 固定費削減

生産性改善による利益最大化の実現

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

生産改革　モジュラーデザイン概要

» 従来の受注後に製造プロセスを開始する方式に対し、モジュラーデザインの推進により先行手配・計画生産等を実現。効率的な生産体制の構築により、大幅な製造リードタイム（L/T）の短縮が可能



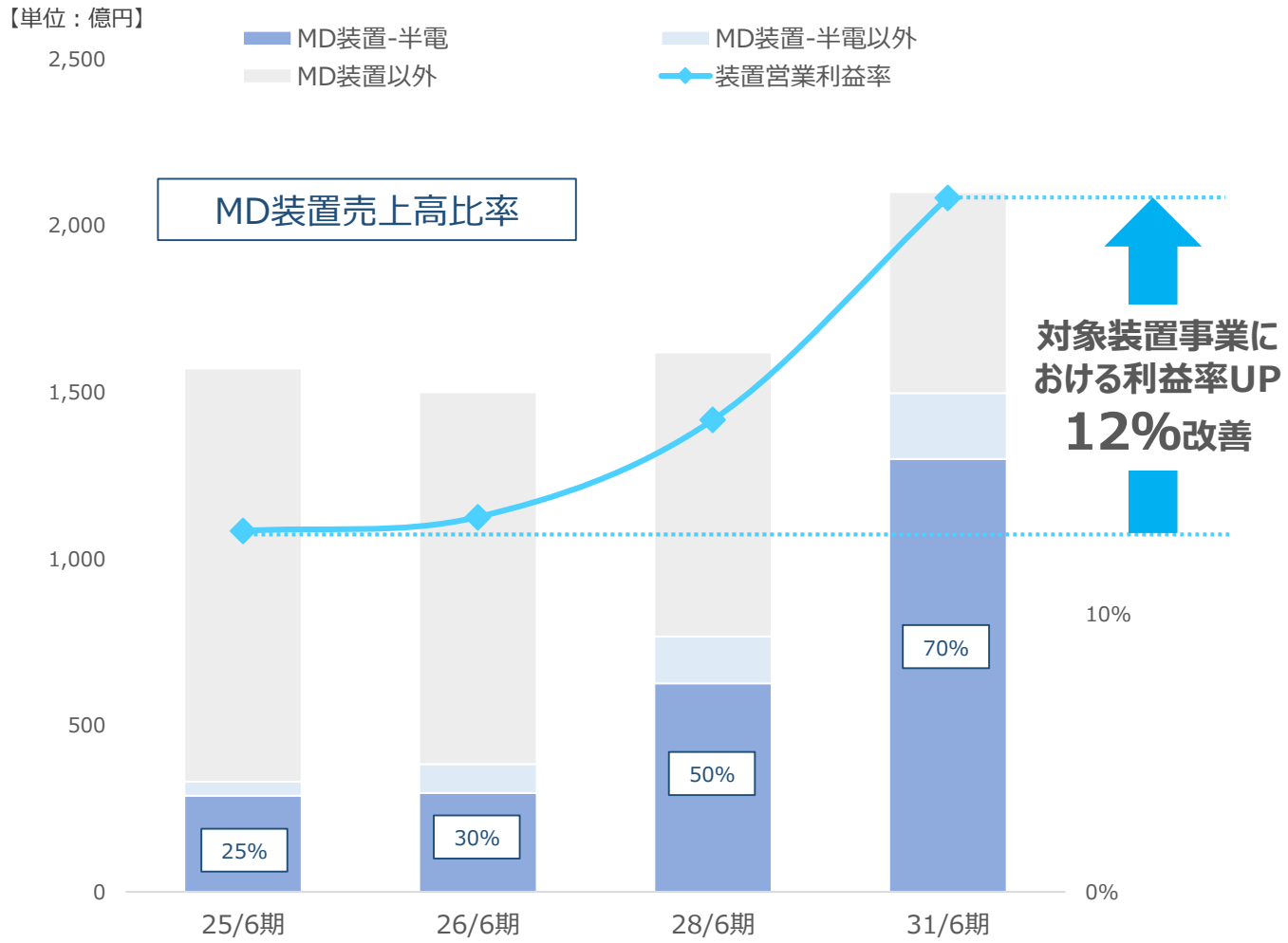
大幅な製造L/T短縮が可能

組立点数	検査工程
6,000点	56工程
▼	▼
2,800点	37工程

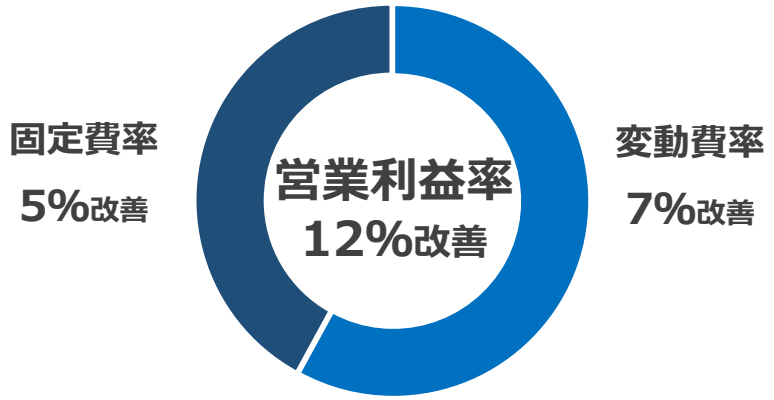
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

生産改革における収益性改善効果（半導体・電子・VMS装置事業）

» 半導体電子中心のモジュラーデザイン装置割合を高め顧客ニーズに迅速に対応し、製造拠点集約を進めることで収益性改善を実現



31/6期まで生産改革効果（対象装置事業）



調達L/T短縮、変動費(率)圧縮

- 部品共通化と計画的まとめ発注で部品価格Down
- 組立予定に合わせた部品調達

設計工数圧縮、L/T短縮

- 図面を変えない組合せ（互換性のある設計）で顧客仕様を実現

製造L/T短縮、出荷台数Up、工数削減

- 標準組立と計画生産で生産最適化

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

2025年6月期　業績概要

2026年6月期　業績予想

新中長期経営計画～ Value Up Plan～

- 事業改革
- 成長戦略
- 生産改革
- 資本政策

成長戦略の方針

半導体電子中心に更なる成長

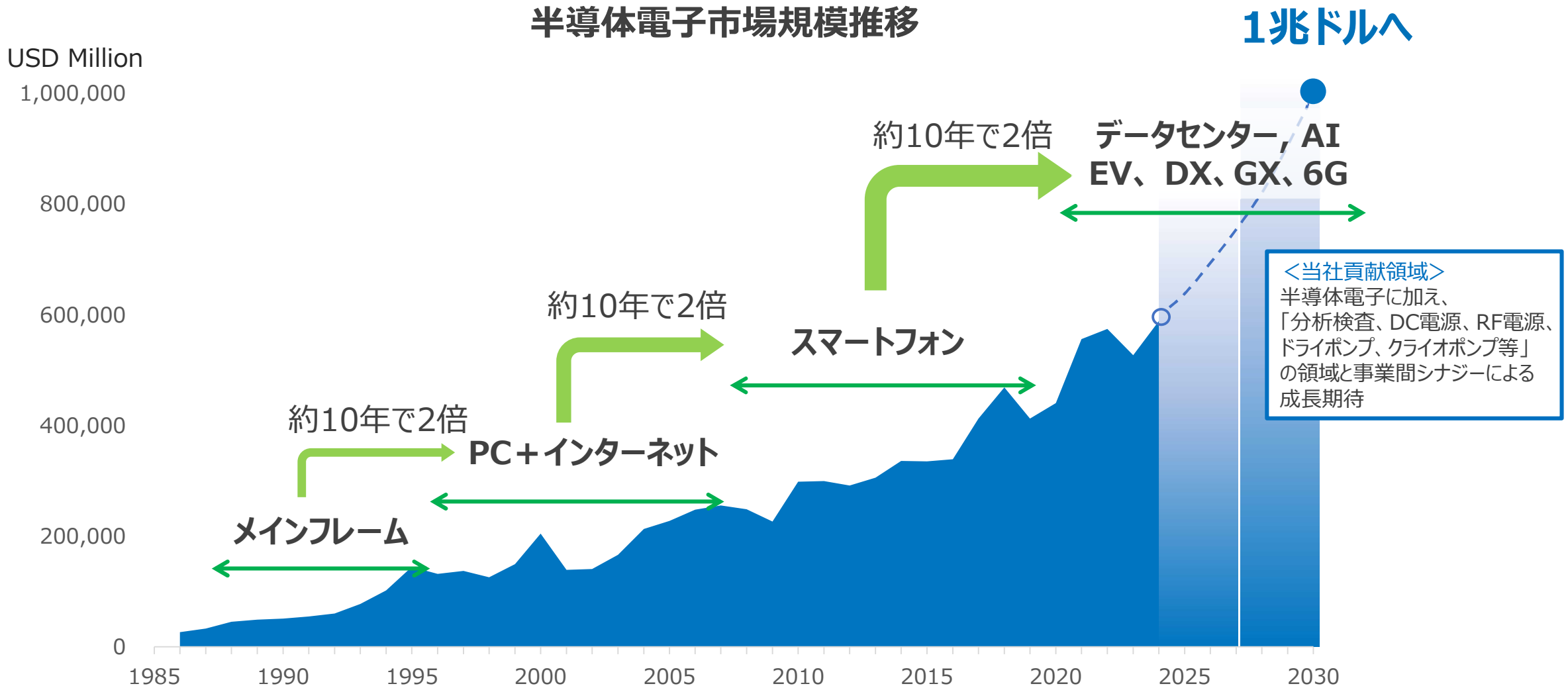
- 事業間シナジーを活用した新たな半導体電子関連ビジネスの創出
- 半導体電子事業の成長加速
- AI関連ビジネス拡大の取り組み
- Ｍ＆Ａを活用したビジネスの拡大

半導体電子を中心とした事業ポートフォリオへの変革を通じて
事業基盤を強化し、高成長/高収益性を目指す

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体電子市場

» 半導体電子市場は2030年に1兆ドルへ成長

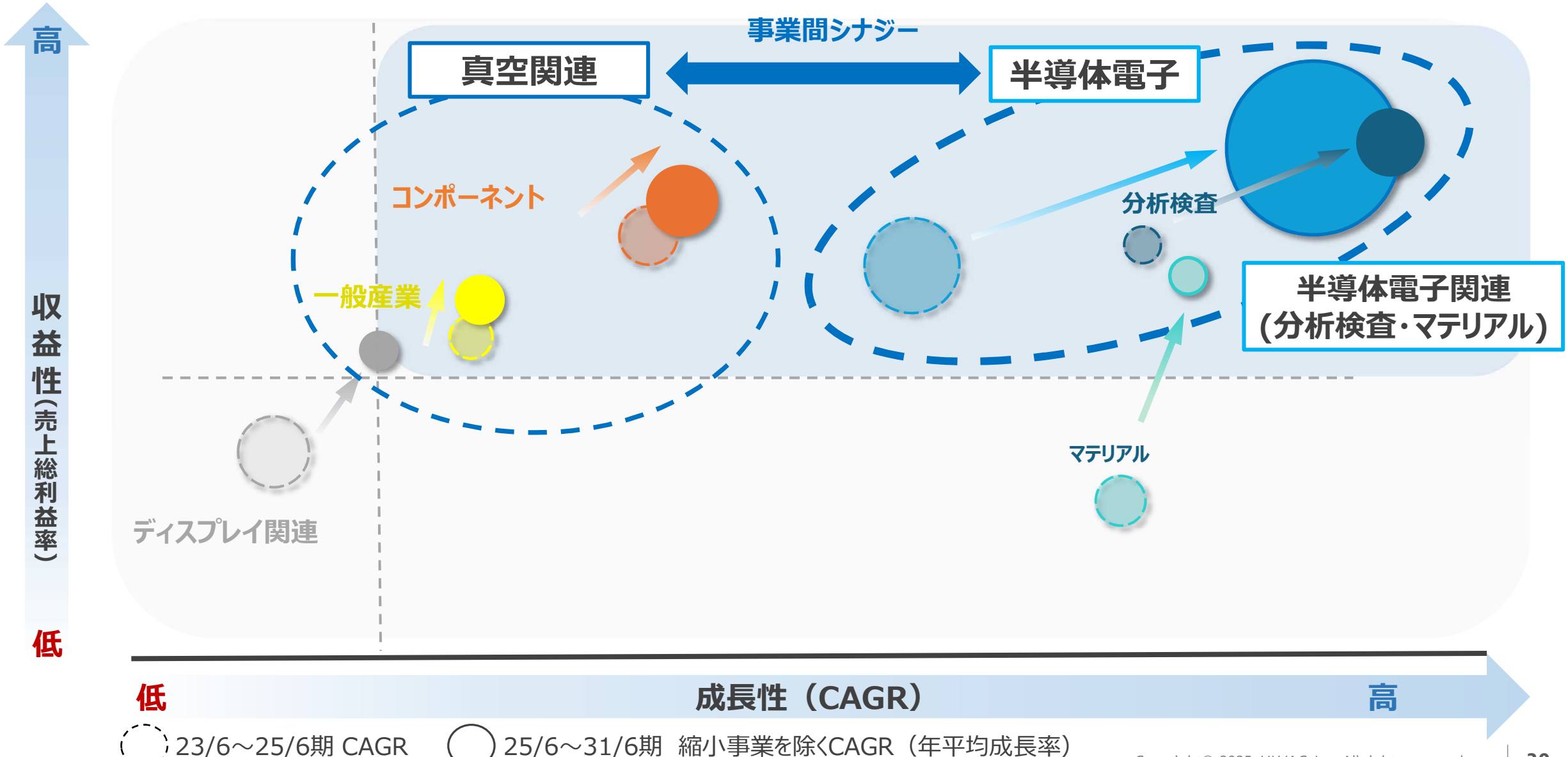


出所：WSTS、SEMI

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

事業ポートフォリオ戦略イメージ

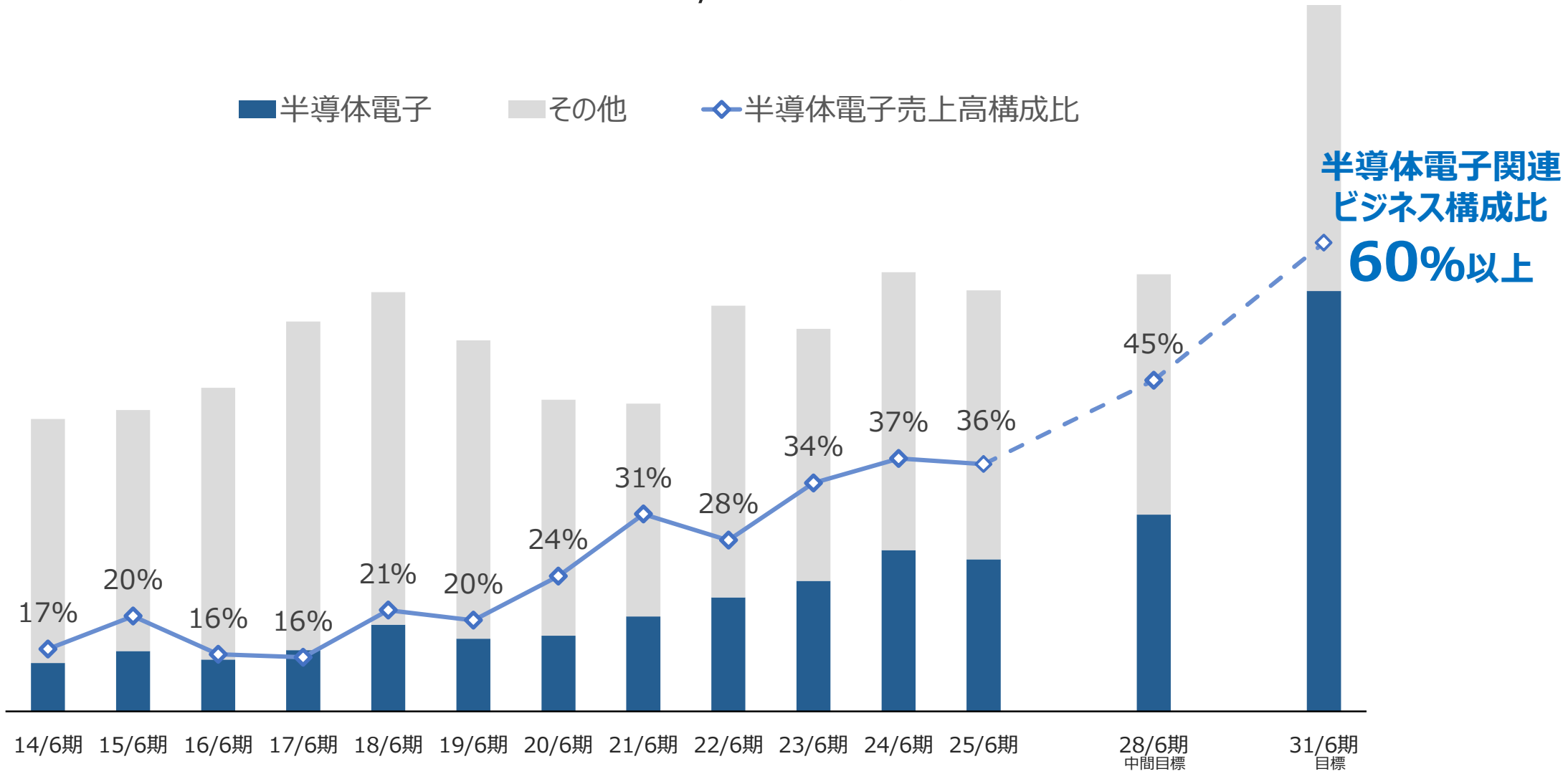
バブルの大きさ：売上高、矢印の先のバブルが将来の姿を示す、将来のバブルは31/6期時点の姿



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体電子売上高構成比の推移

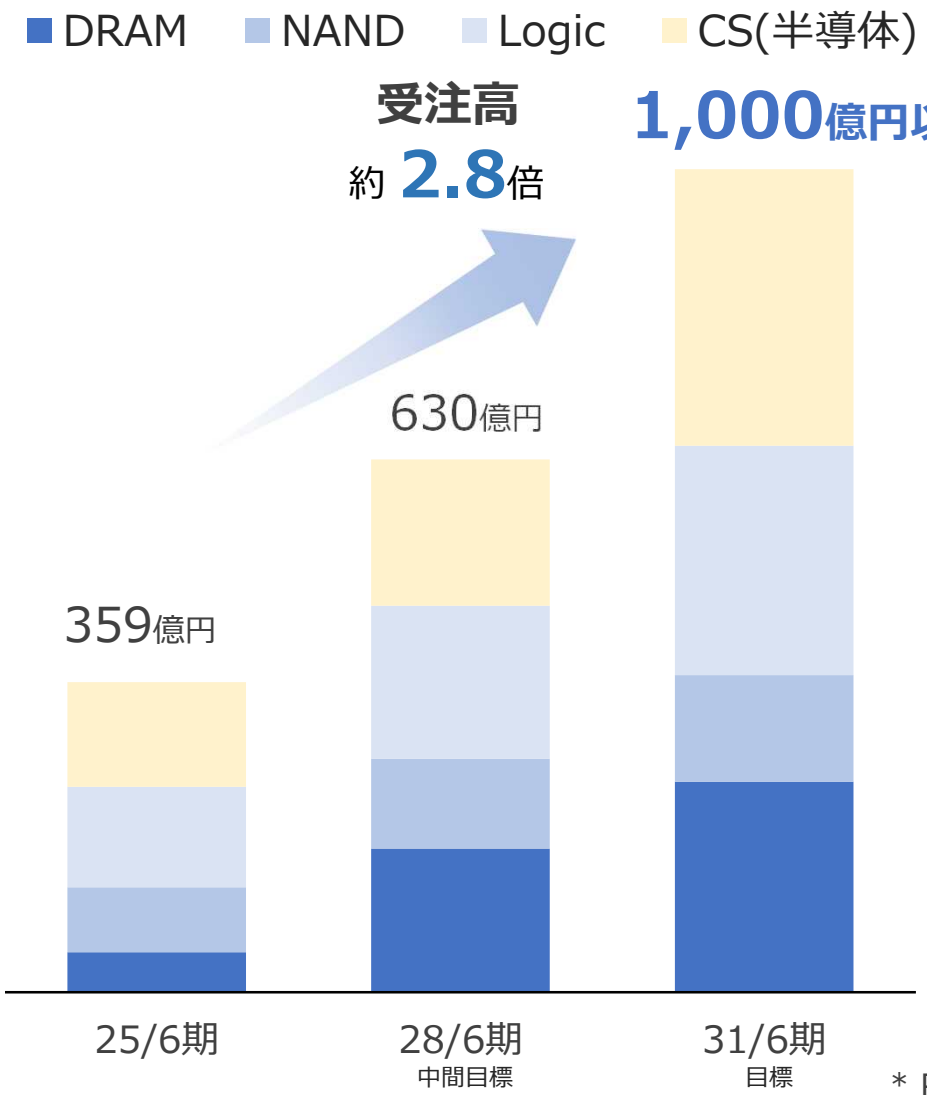
» バリューアッププランにより獲得する筋肉質な体制を基に、半導体電子への注力加速・事業間シナジーを活用した新たな半導体電子関連ビジネスの創出により、高成長/高収益性を実現



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

成長戦略　半導体の成長シナリオ

» 実績のあるハードマスク技術や金属成膜技術を基盤に、重要顧客のPOR*数を増加し、新工程の獲得によるシェア拡大を図り、31/6期：受注1,000億円以上を目指す



成長戦略

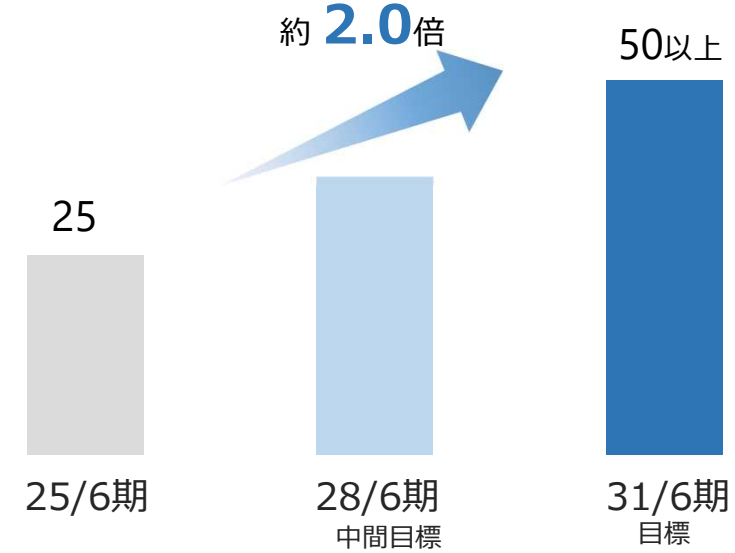
① HM技術の応用で高密度成膜による機能膜へ

② HM工程Top Makerの地位確立とCu配線波及

③ 先端Logic Cu配線 / Post-Cu配線工程獲得による PVD Marketシェア拡大

④ CS事業拡大と深化

重要顧客POR数



＊ Process of Record：量産に使われる認定プロセス

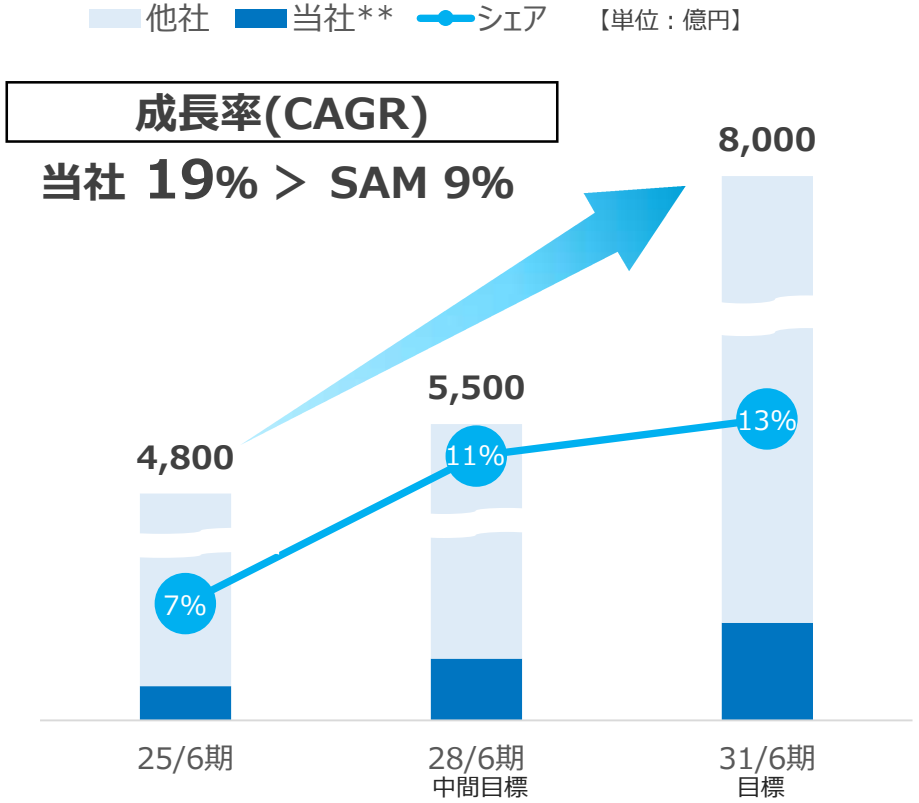
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体市場規模＆当社ポジション

» 半導体スパッタリング市場の成長率を上回る成長実現に向けて、ロジック分野ではハードマスク技術で新工程を開拓し、メモリ分野では韓国トップメーカーとの共同開発加速でシェア拡大

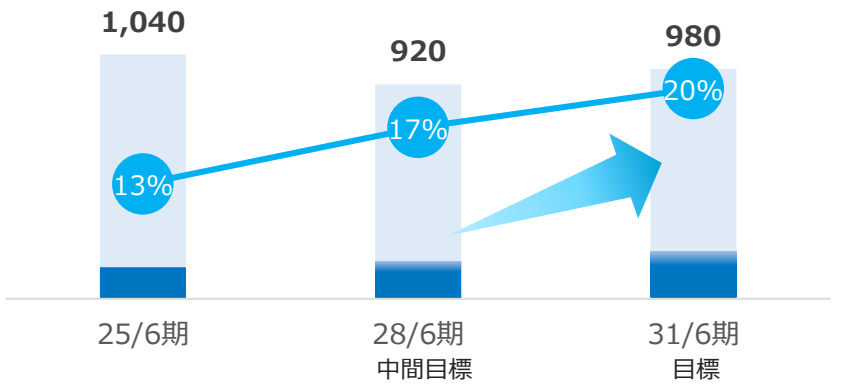
半導体スパッタリング装置市場*（SAM） ＆ 当社市場シェア

半導体スパッタリング装置市場（主要6社＋成熟ロジック）

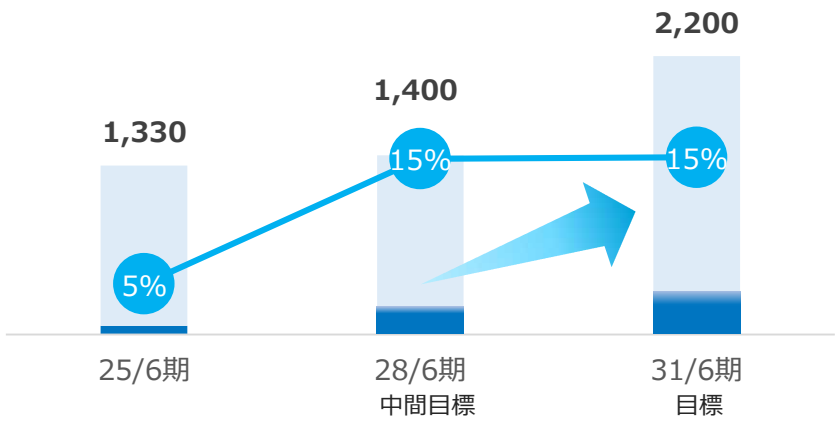


* Gartner等を基に当社推計
** 受注高（CS含む）

ロジック注力分野 ハードマスク工程



メモリ注力分野 韓国メモリ



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体・ロジック　成長ロードマップ

技術トレンド	当社強み
微細化進展	ストレス制御
新材料の導入	低パーティクル成膜
	低温成膜技術

■ 成長ロードマップ

新材料・低抵抗成膜技術の展開

低抵抗新材料

☆ 実績あり

先端ロジック 金属配線工程獲得

Cu配線　　Al・W工程

ストレス制御・低パーティクル成膜を強みとしたハードマスク技術展開

★BEOL配線形成用ハード・マスク　★GAA形成用ハードマスク　裏面配線形成用ハード・マスク

顧客技術ロードマップ	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Logic	2nm		A14		A10		A7	

中長期目標

ハードマスクPVD＋金属配線工程奪取でシェア確立

- 5ナノ、3ナノのデファクトスタンダードであるメタル・ハードマスク技術を軸に、ハードマスク用途と応用技術プロセスにてシェア確立
- PVDが最も多く使われている金属配線工程の参入・拡大を目指す

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体・メモリ　成長ロードマップ

技術トレンド	当社強み
微細化進展	低パーティクル成膜
3D構造の加速	ストレス制御
新材料の導入	高密度成膜

■ 成長ロードマップ

CVD・ALDインテグレーション

先端メモリメーカーと開発中

新材料・低抵抗成膜技術の展開、中工程配線の展開

Cu Bonding　　新材料

☆ 実績あり

金属膜工程・HM工程等の最先端メモリ工程の展開、顧客拡大

★ Cu・Al・W・TiN配線工程　　★ HBM用配線工程　　裏面成膜（接合、Stress制御）

顧客技術ロードマップ	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DRAM	13nm	<12nm		<11nm		<10nm		
NAND	288L		3XX		4XX		4YY	

中長期目標

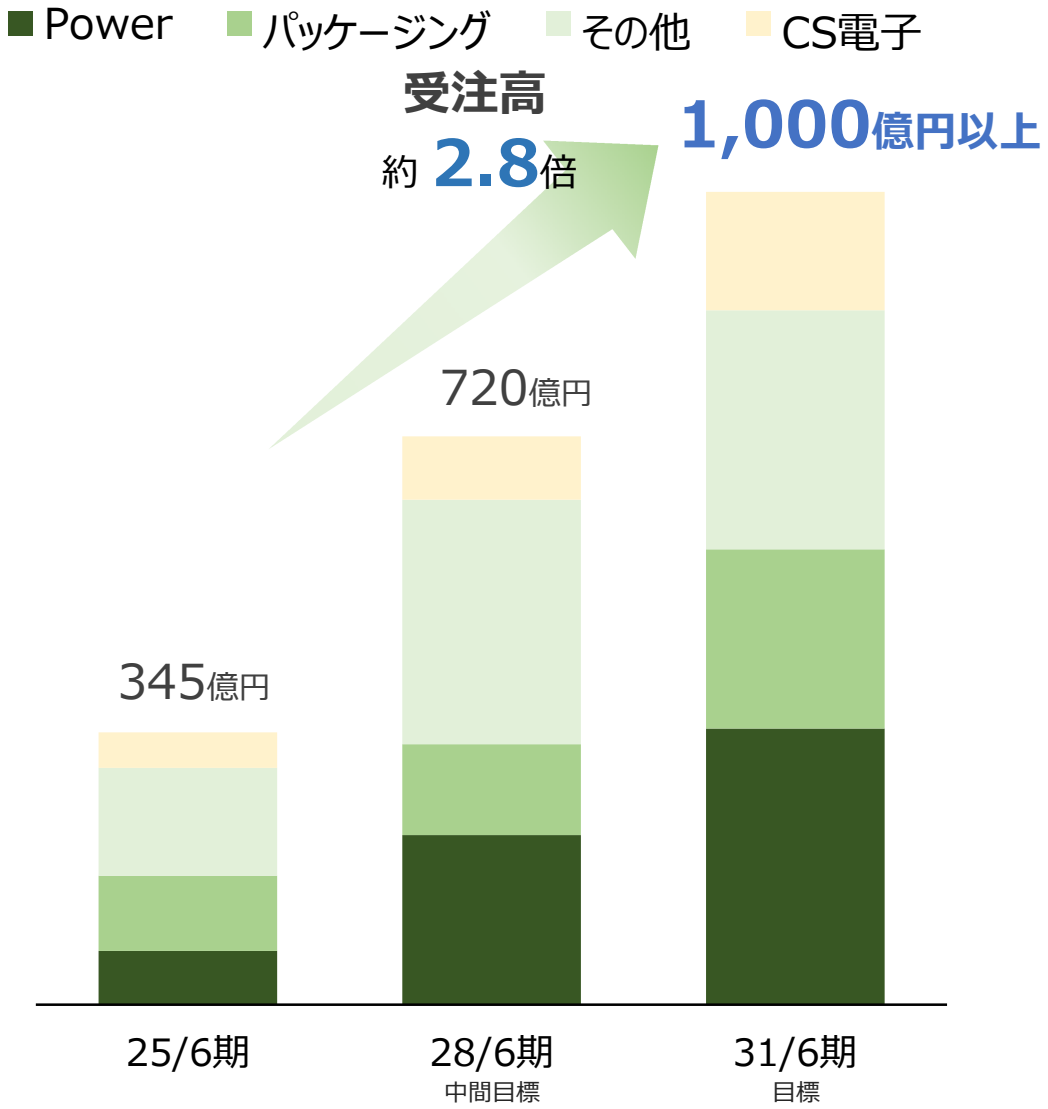
メモリ工程のシェア最大化

- 韓国トップメーカーとの共同開発加速による工程数拡大（テクノロジーセンター活用）
- 新材料及び新構造に対応したソリューションの提供による工程拡大

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

成長戦略　電子デバイスの成長シナリオ

» パッケージングビジネスの活発化、パワーデバイス投資の回復等で1,000億円以上のビジネス規模へと拡大、更なる成長を目指す



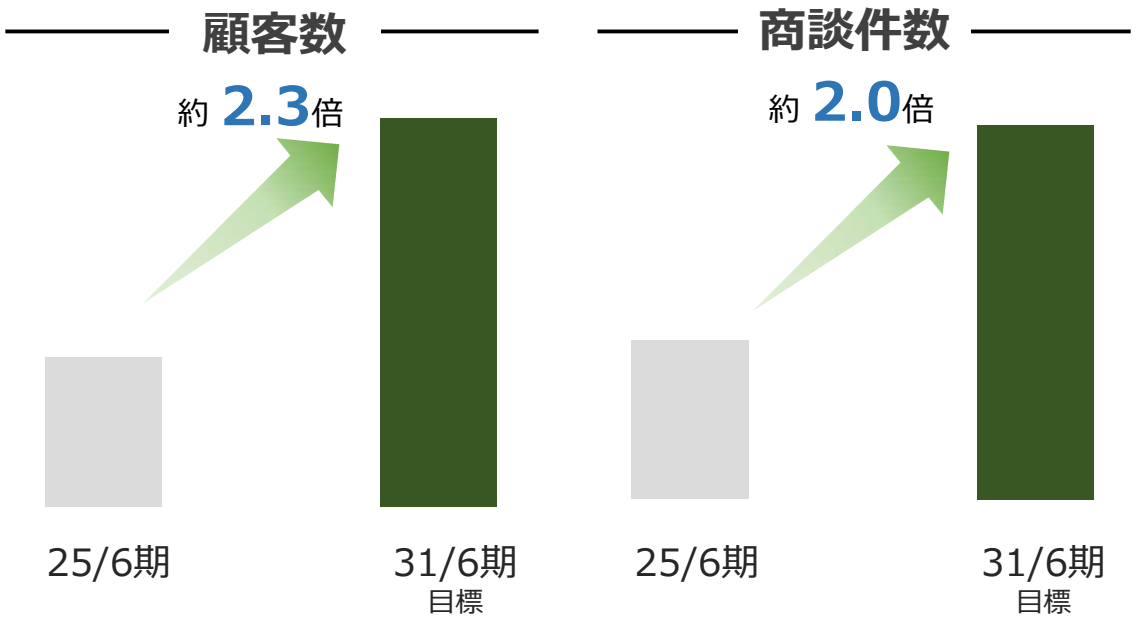
成長戦略

① SiC向けスパッタ・イオン注入に加え、GaN量産対応による適応拡大

② 先端パッケージングの投資拡大・新工程獲得

③ 通信機器の小型化に貢献するTFLN（薄膜リチウムニオブ酸）エッチング量産対応による光電融合ビジネス展開

④ CS事業拡大と深化

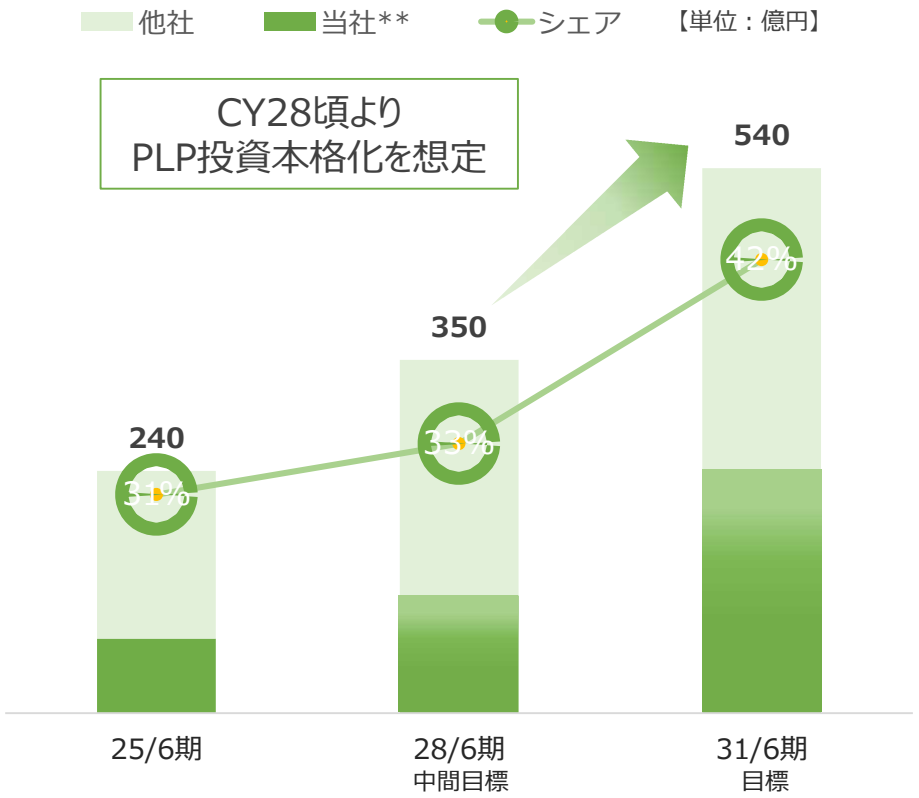


Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

電子デバイス市場規模＆当社ポジション

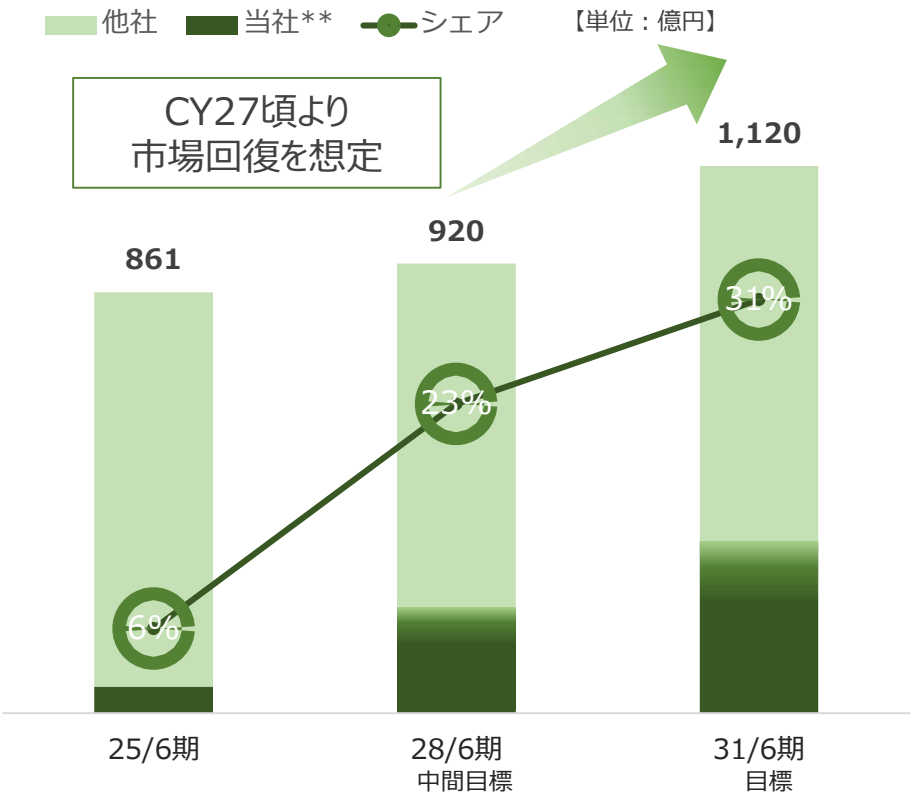
» AIサーバー市場拡大に伴い、パッケージ市場は成長継続。先端パッケージ・アッシング分野中心にシェア拡大
» 電動化・省エネルギー化の進展により、パワーデバイス市場は拡大継続。革新する技術に応え、シェア拡大

パッケージング・アッシング市場 SAM* & 当社市場シェア



パワーデバイス・SiC、GaN市場 SAM* & 当社市場シェア

（スパッタ・インプラ装置市場）



* 当社調べによる推計
** 受注高(装置のみ、CS除く)

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

電子デバイス・パッケージング　成長ロードマップ

技術トレンド	当社強み
微細化進展	低ダメージプラズマ技術
新構造導入	ガラス基板成膜/加工技術
基板面積拡大	

■ 成長ロードマップ

次世代パッケージング向けへの展開

- 次世代Panal用デスカム
- Direct Viaエッチング

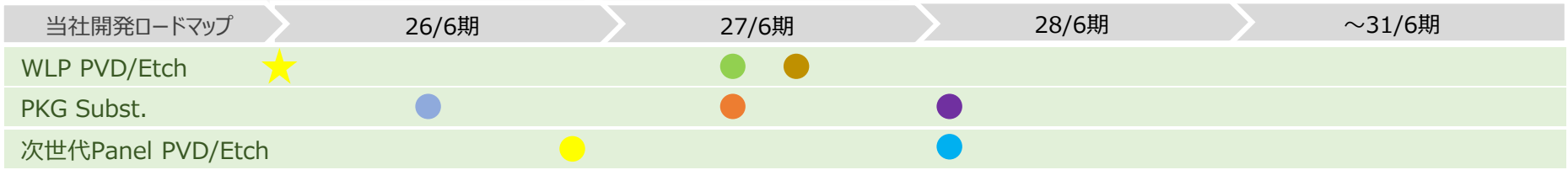
パッケージ基板拡大による機会拡大

- パッケージ基板用デスミア
- パッケージング基板用デスカム
- 電極形成スパッタリング

プラズマ技術を強みとした先端パッケージング向け装置の席巻・新工程展開

- ★インターポーザー用デスカム
- プラズマ表面活性化（Hybrid Bonding）
- プラズマダイシング

☆ 実績あり
○ リリース予定



中長期目標

パッケージング工程で唯一無二の存在

- デスカム工程向けアッシング装置のシェアNo1堅持
- FPD技術で培ったノウハウ等で確実にPLPビジネス展開
- 新構造に対応した各種装置の連続リリースによる拡大

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

電子デバイス・パワーデバイス　成長ロードマップ

技術トレンド	当社強み
新材料導入	豊富な実績による高信頼性
新構造導入	化合物成膜、加工

■ 成長ロードマップ

☆ 実績あり
○ リリース予定

新材料に即応したソリューション提供

- 酸化ガリウム（Ga2O3）
- ダイヤモンド

窒化ガリウム（GaN）対応の技術展開

- GaN スパッタリング
- GaN エッチング
- 大型化対応 GaNスパッタリング

炭化ケイ素（SiC）対応装置の市場シェアを堅持し、更なる拡大を目指す

- ★ SiC イオン注入
- ★ 裏面電極スパッタリング
- ● 表面配線形成スパッタリング

中長期目標

革新するパワーデバイス技術に、最適解の装置提供

- SiCイオン注入装置の中国市場トップシェア維持　（シェア：7割以上）
- 裏面電極スパッタリング装置の日本市場トップシェア維持（シェア：7割以上）
- SiC→GaN→新材料へと移り行く材料変化にも柔軟に適応

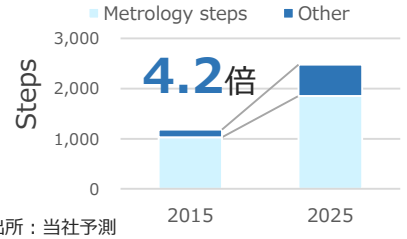
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

成長戦略：分析検査装置　Lab to Fabへの挑戦

» 既存Lab型での経験と実績（シェアNo.1）を活かし、半導体電子との事業間シナジー等により、製造プロセス高度化による分析の重要度が高まるFab型へ“XPS”を本格投入し、検査装置市場におけるグローバルポジションの確立を目指す

市場環境

半導体製造工程は10年間で倍増し、
中でも検査工程は4倍に



出所：当社予測

技術・要求トレンド

- 微細化進展に伴う工程数UP
- 歩留まり改善ニーズの高まり
- 品質管理の重要度向上

当社強み

- 表面分析専業メーカーの実績
- R&D～サービス一貫体制
- Software（Science）、Hardware（物理・光学設計、製造）の両面から価値を提供

～25/6期

研究開発向けXPS分析機器トップシェア

- 研究開発向けXPS分析機器の拡大
- 半導体量産ライン向けXPS検査装置のプロトタイプ開発

研究開発向けXPS分析機器

～27/6期

半導体量産ライン向けXPS検査装置の市場投入

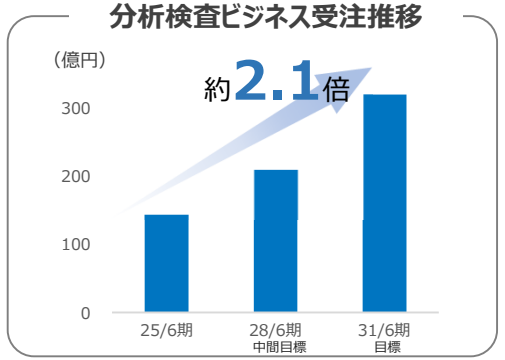
- 研究開発向けXPS分析機器の高品質化
- **半導体量産ライン向けXPS検査装置の製品リリース**

半導体生産ライン向けXPS検査装置イメージ

～31/6期

グローバル展開による更なる拡大を目指す

- 研究開発向け分析機器のラインナップ強化
- 半導体量産ライン向けXPS検査装置の工程拡大
- 分析機器・検査装置で受注**300億円**規模の事業化



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

成長戦略　コンポーネントビジネスの拡充

» 一般産業から半導体・電子部品、医療分野まで幅広い市場・用途に適応する充実した製品ラインナップを持つ強みを更に磨き、成長を目指す

真空ポンプ

多様な市場・アプリケーションに拡販

ドライポンプ

理化学・分析市場　国内トップシェアの小型ポンプに加え、半導体・電子市場向けポンプのラインアップ拡充によりシェア拡大

クライオポンプ/4K・希釈冷凍機

冷却技術で新市場開拓

低温機器（クライオ）

小型省エネクライオポンプを半導体電子分野へ展開

極低温技術を応用し、医療分野と量子コンピュータ市場へ挑戦

計測機器・成膜電源

アライアンスによるグローバル対応加速

ヘリウムリークディテクター

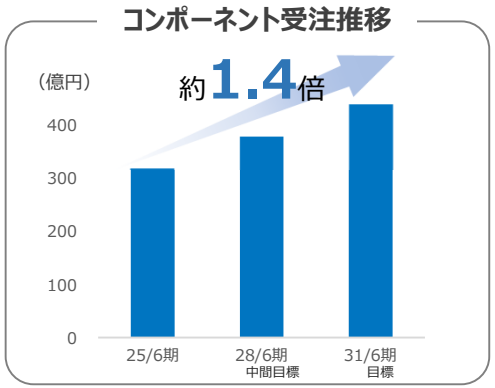
EV関連ビジネスの拡大に加え、アライアンス強化を通じてグローバル半導体市場向け受注拡大

デジタル制御電源の展開によるシェア拡大

10kW Digital DC電源

デジタル制御技術をDC・RF・EB電源へ展開し、半導体・電子市場拡販

省エネRF電源・省スペースEB電源等、新製品を市場投入



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

成長戦略　真空関連ビジネスの革新

» 真空技術の可能性を最大化し、新たな価値創造で成長を目指す

熱処理炉

一般産業用装置

レガシー装置の競争力向上

焼結処理・熱処理炉

高性能熱処理炉で高シェア堅持。FPD分野で培った大型量産装置のノウハウを活かし、装置の効率化と最適化を進め、競争力のあるソリューションを提供

リークテスト装置

一般産業用装置

アプリケーション展開によるビジネス拡大

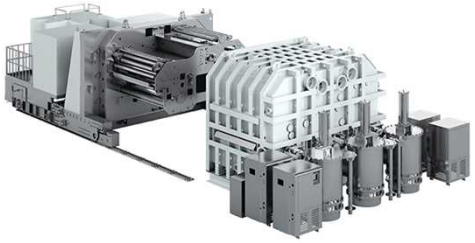
EVバッテリー用リークテスト装置

高性能リークテスト装置の高シェア堅持。空調・EV用途に加え、データセンター向け冷却システムなど幅広い用途への対応とカスタマイズ力に強み

Roll to Roll

ディスプレイ・エネルギー関連製造装置

幅広化対応による生産効率アップで市場奪取

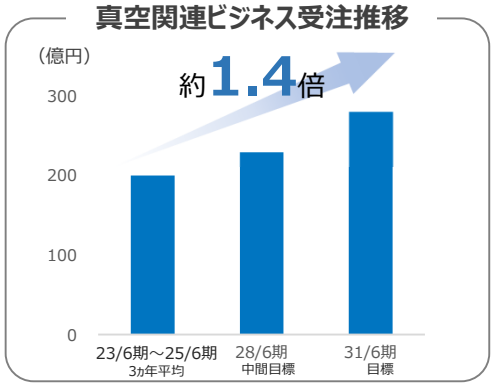


両面蒸着巻取装置
（1.6mフィルム幅対応モデル）

リチウム電池の安全性向上が求められている中、Al両面蒸着膜（下図①）への注目が高まる。フィルム幅（1.6m→2.5m）による生産性向上により面積あたりの生産コストを改善し、変化し続ける技術要求に的確に応えることで、No.1地位を堅持

図:両面蒸着膜適用リチウム電池構造

ACC向けCu両面蒸着膜（②）、負極向けリチウム両面蒸着膜（③）は開発継続、早期実現を目指す



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

2025年6月期　業績概要

2026年6月期　業績予想

新中長期経営計画～ Value Up Plan～

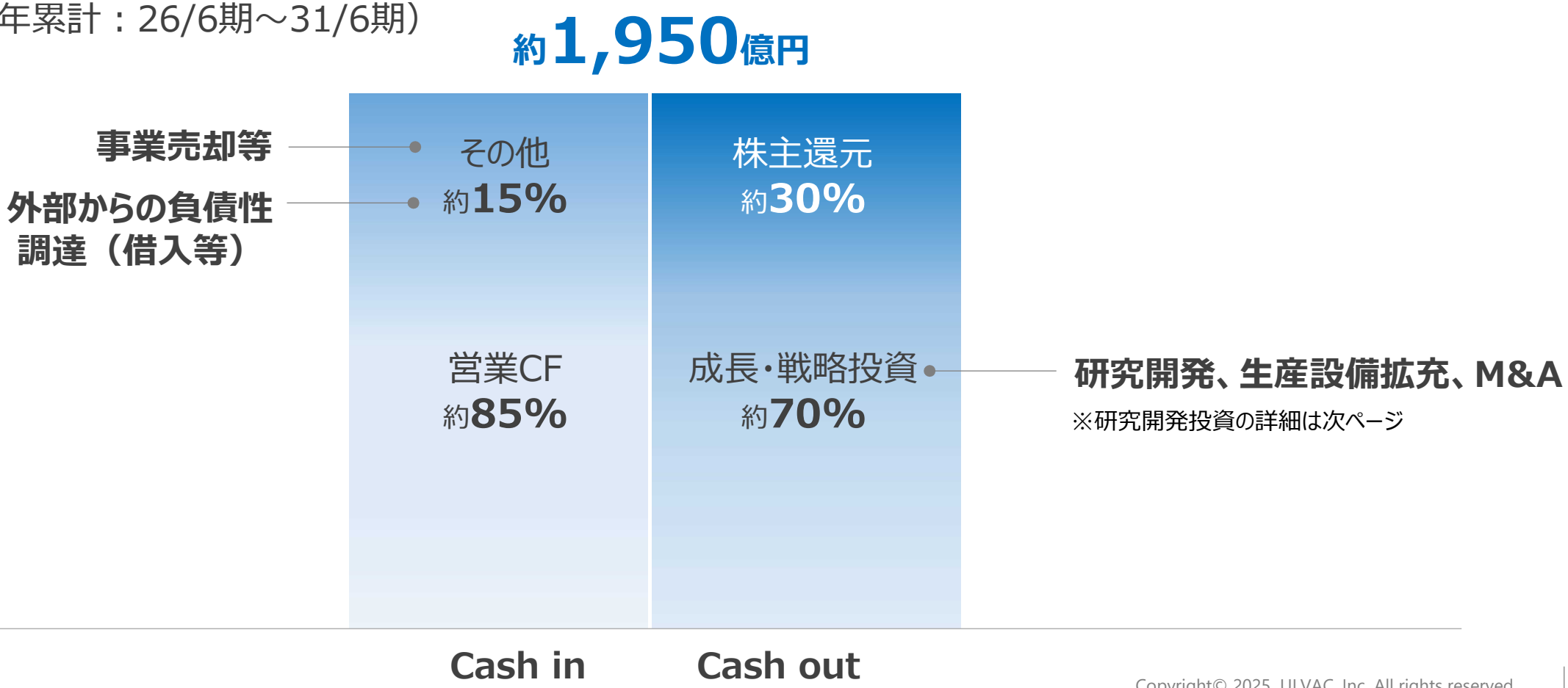
- 事業改革
- 成長戦略
- 生産改革
- **資本政策**

キャピタルアロケーション

» 半導体電子を中心に、成長のための**開発投資強化やM&Aを実施**

» 株主還元を最重要施策の一つと位置づけ、持続的な成長による**長期的な増配**に加え、将来的にはさらなる**株主還元の拡充**を目指す

■ **キャピタルアロケーション**
（6か年累計：26/6期～31/6期）



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

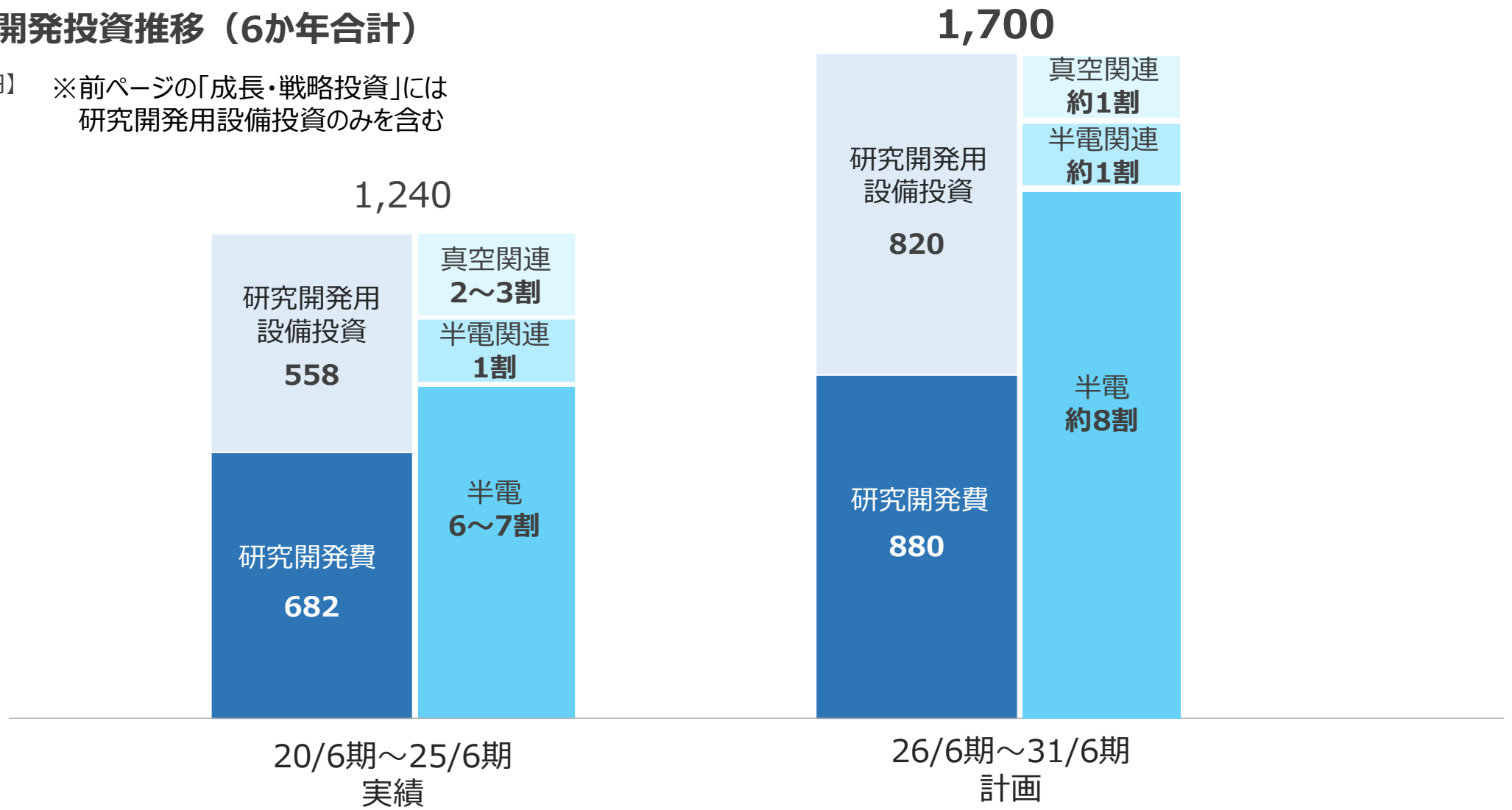
研究開発投資：半導体電子の研究開発強化

» 半導体電子中心に研究開発強化 ⇒ さらなる成長に向けた研究開発投資継続

■ 研究開発投資推移（6か年合計）

【単位：億円】

※前ページの「成長・戦略投資」には
研究開発用設備投資のみを含む



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

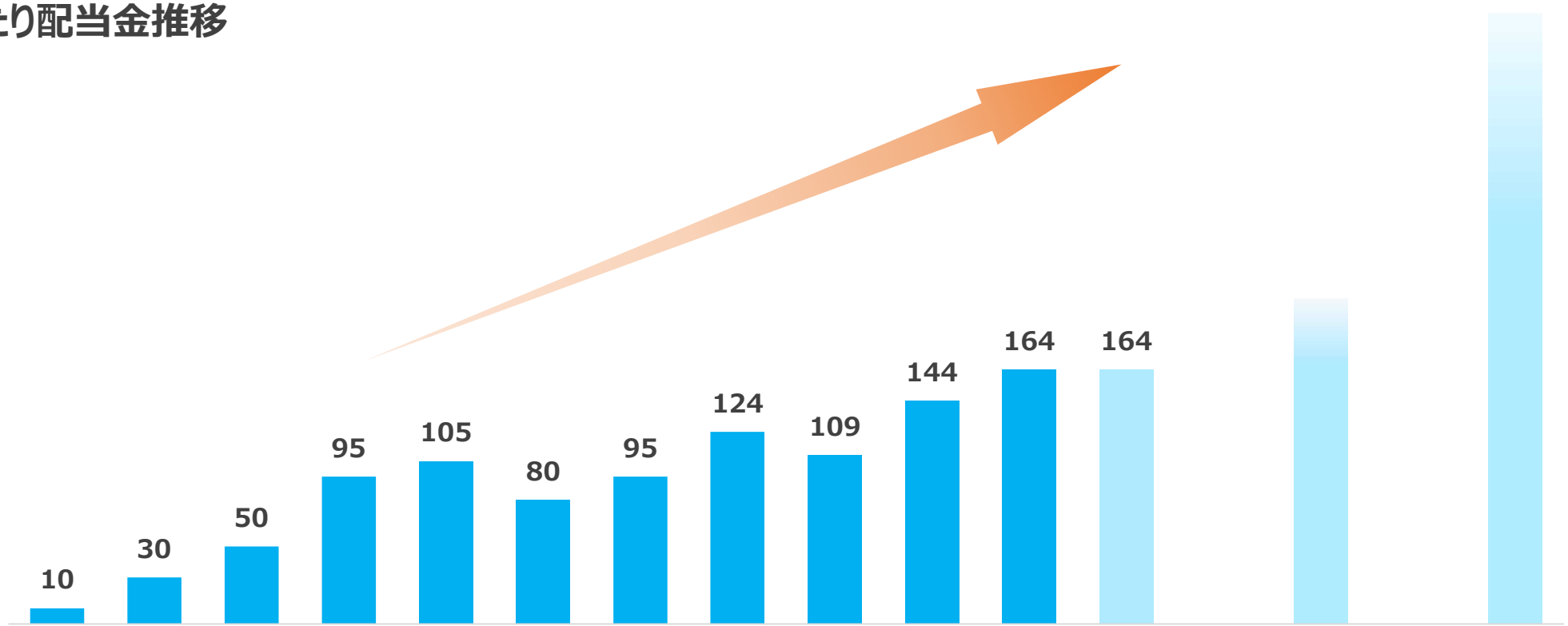
株主還元方針

» 引き続き、**業績連動配当性向は35%以上を目途**とし、株主還元重視による安定配当の観点から、26年6月期の配当は25年6月期と同額の1株当たり164円を予定

» 持続的な成長による**長期的な増配**に加え、将来的にはさらなる**株主還元の拡充**を目指す

■ 1株当たり配当金推移

【単位：円】



	15/6期	16/6期	17/6期	18/6期	19/6期	20/6期	21/6期	22/6期	23/6期	24/6期	25/6期	26/6期
配当性向(%)	5.8	8.9	10.1	13.0	27.7	36.6	31.5	30.2	37.9	35.1	35≦	35≦

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

トピックス

組織変更：グロース＆デベロップメント室新設

バリューアッププランの実現サポート及びグローバル戦略策定・
成長施策の実行を通じて、グループ全体のビジネス成長を加速

代表取締役社長CEO

- 経営企画室
- グロース＆デベロップメント室
- 事業戦略室
- サステナブル経営推進室
- 安全保障貿易管理部
- 品質保証部
- 法務部
- 監査室
- 管理本部 — 総務部・人事部・財務経理部・IR部 営業管理部・IT企画推進部 九州工場・東北工場（拠点管理）
- 開発本部 — 先進技術研究所・未来技術研究所
- 生産本部 — 生産統括部・調達部
- 半導体電子事業本部 — 半導体BU・電子機器BU
- コンポーネント事業本部 — コンポーネントBU
- マテリアルBU
- VMSBU
- CS事業本部

富士裾野工場の使用電力：実質再生可能エネルギー100%実現

2025年7月に半導体電子事業の主要拠点である富士裾野工場において、使用電力すべてを実質的に再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを完了。

今後とも、太陽光発電設備の導入を計画的に進めるとともに各種再エネ調達を推進していくことで、持続可能な社会の実現に貢献する。

富士裾野工場

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

参考資料

業績（四半期推移）

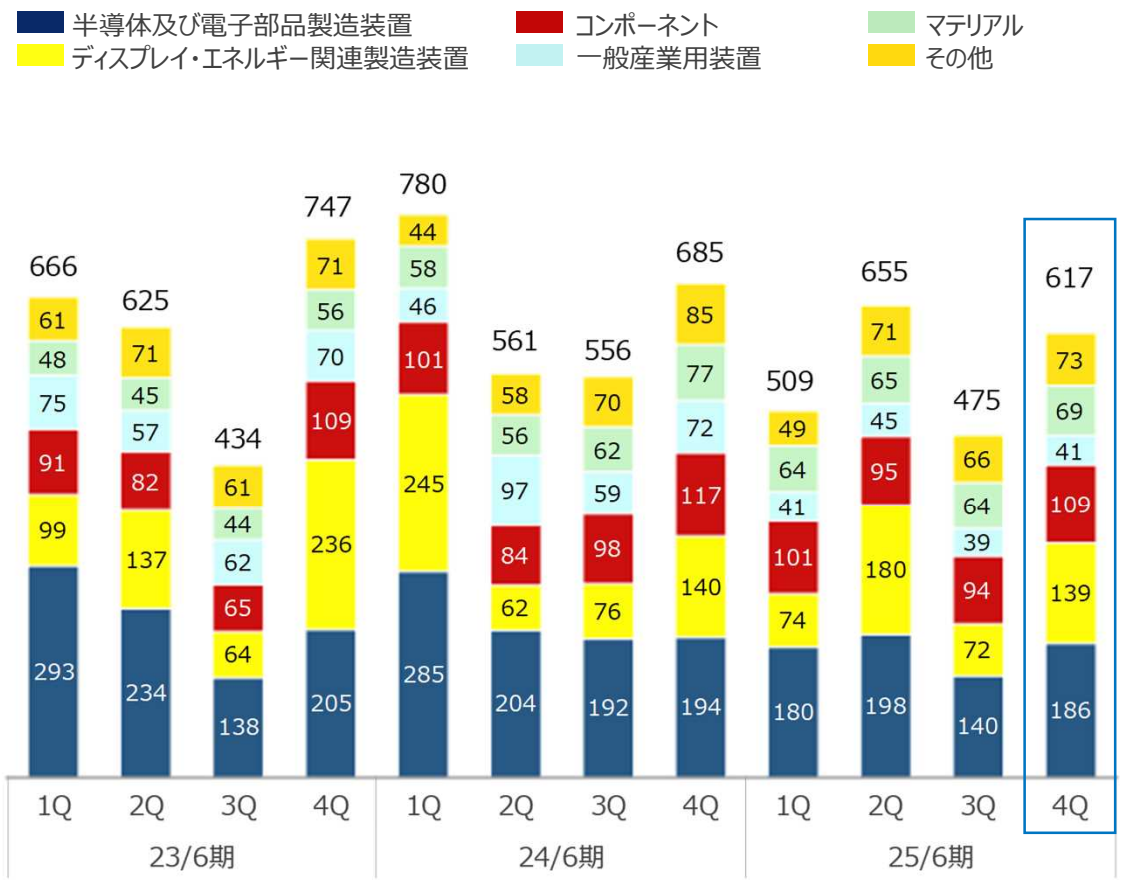
【単位：億円】	2024/6期					2025/6期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
受注高	780	561	556	685	2,582	509	655	475	617	2,256
売上高	550	652	650	759	2,611	610	739	529	635	2,512
売上総利益	153	201	220	233	807	191	238	176	193	799
率	27.7%	30.8%	33.8%	30.7%	30.9%	31.3%	32.2%	33.3%	30.5%	31.8%
販管費	124	126	119	139	509	134	142	122	136	533
営業利益	28	75	101	94	298	58	96	54	58	265
率	5.1%	11.5%	15.5%	12.3%	11.4%	9.4%	13.0%	10.2%	9.1%	10.6%
経常利益	29	81	95	93	298	69	92	61	65	286
率	5.3%	12.4%	14.6%	12.3%	11.4%	11.3%	12.4%	11.5%	10.2%	11.4%
親会社株主に帰属する四半期純利益	11	57	64	69	202	37	67	27	36	167
率	2.1%	8.8%	9.9%	9.1%	7.7%	6.1%	9.0%	5.1%	5.6%	6.6%

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

受注高・売上高実績（四半期推移）

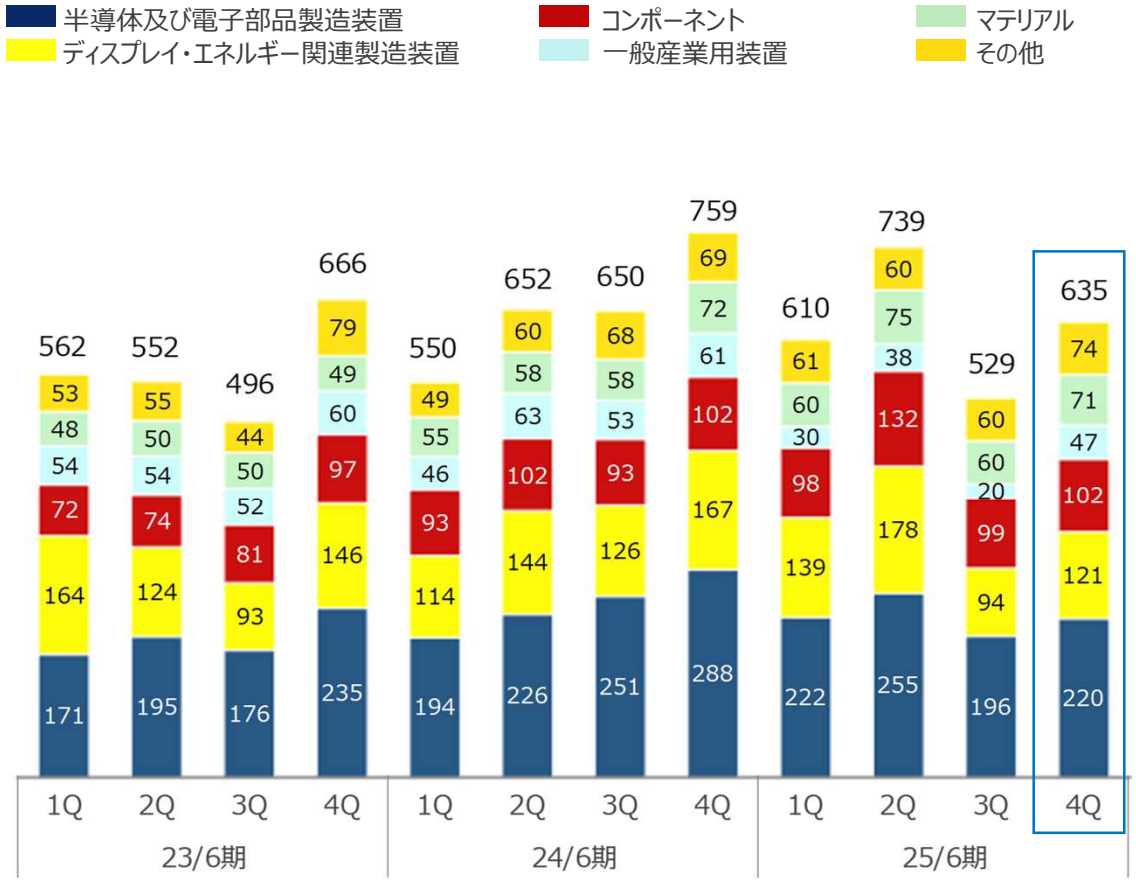
受注高

【単位：億円】



売上高

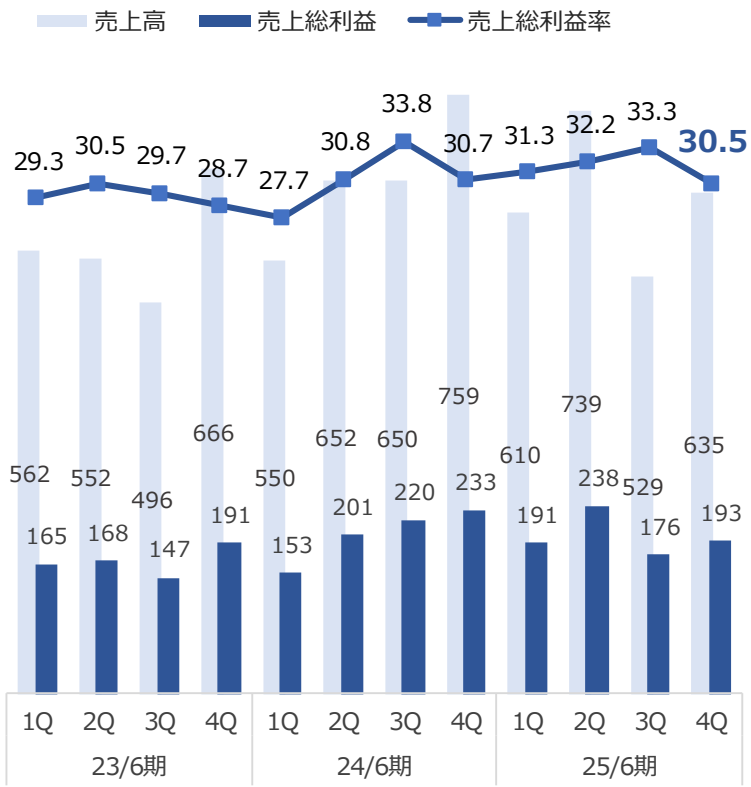
【単位：億円】



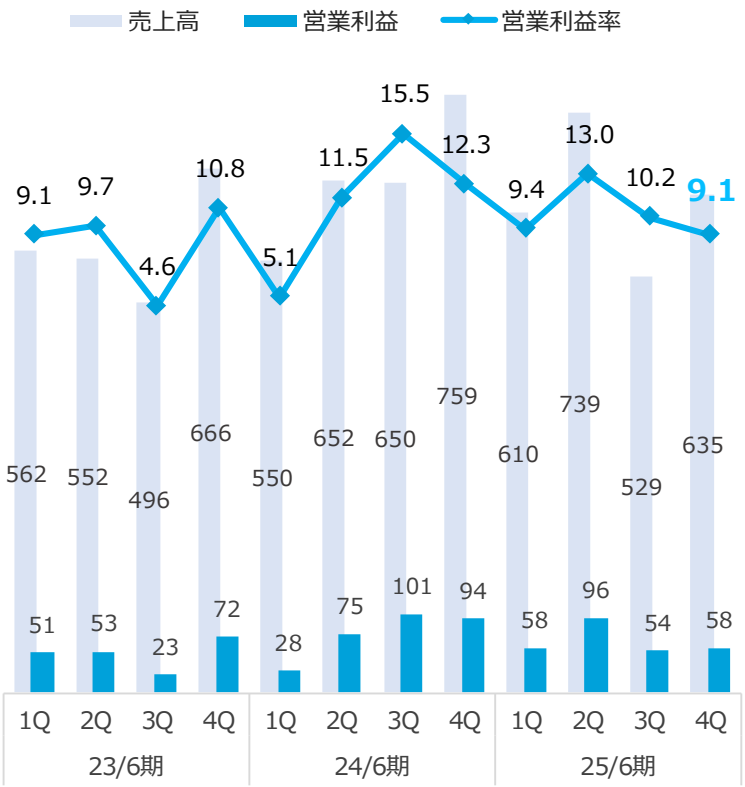
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

利益率（四半期推移）

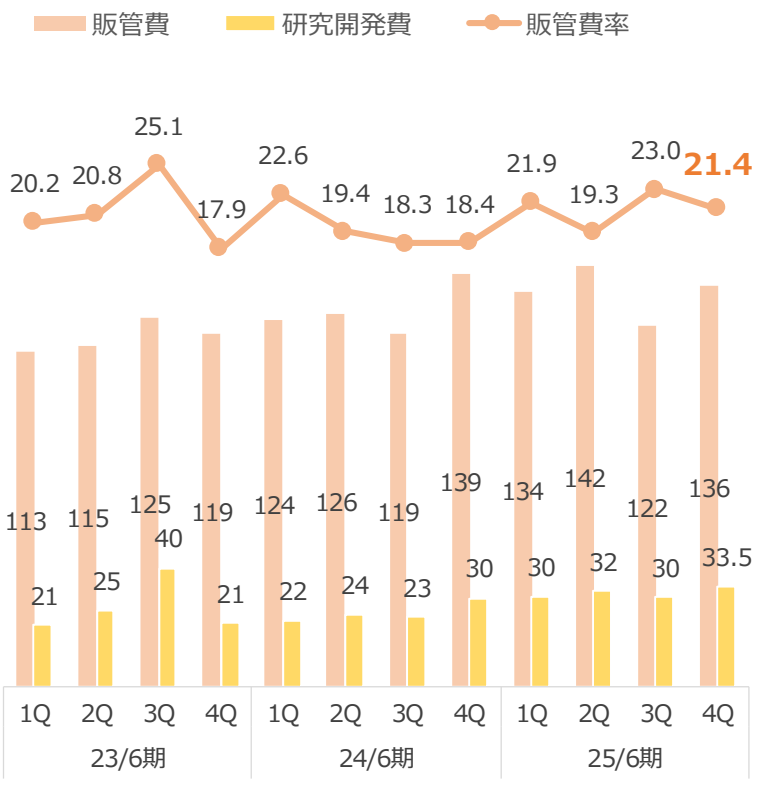
売上総利益率 【単位：億円、%】



営業利益率 【単位：億円、%】



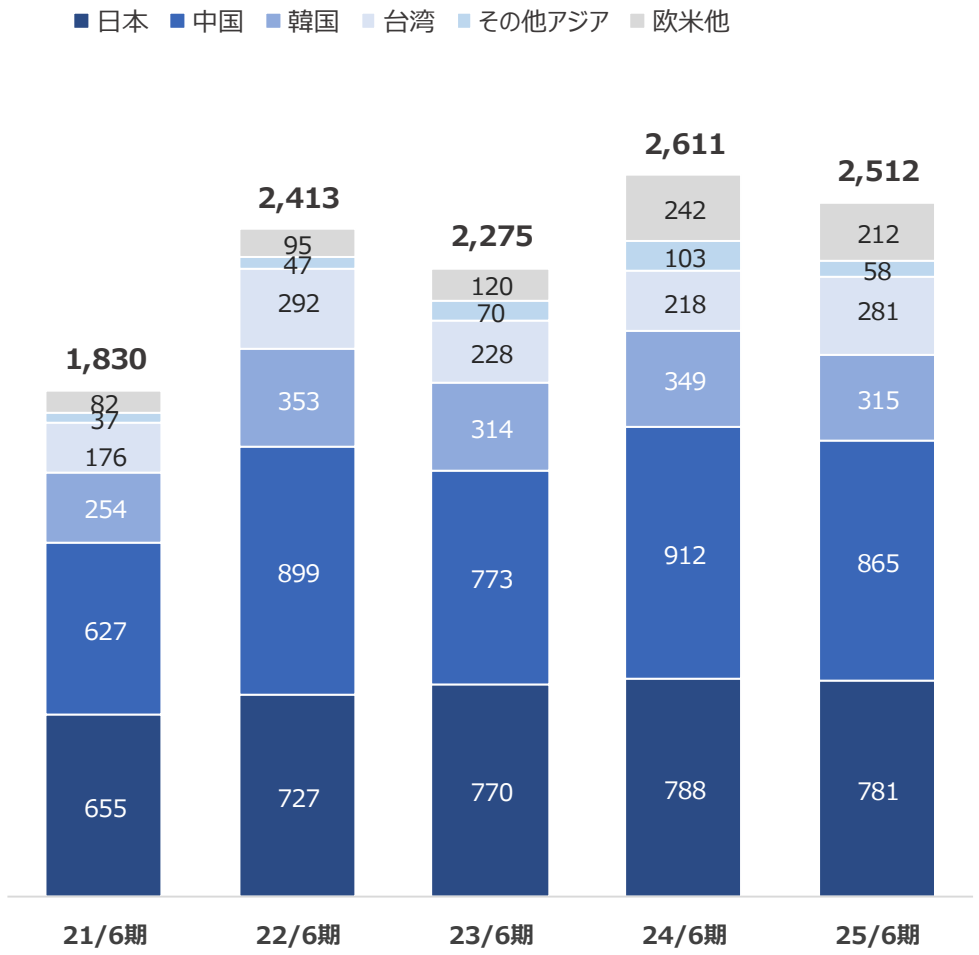
販管費率 【単位：億円、%】



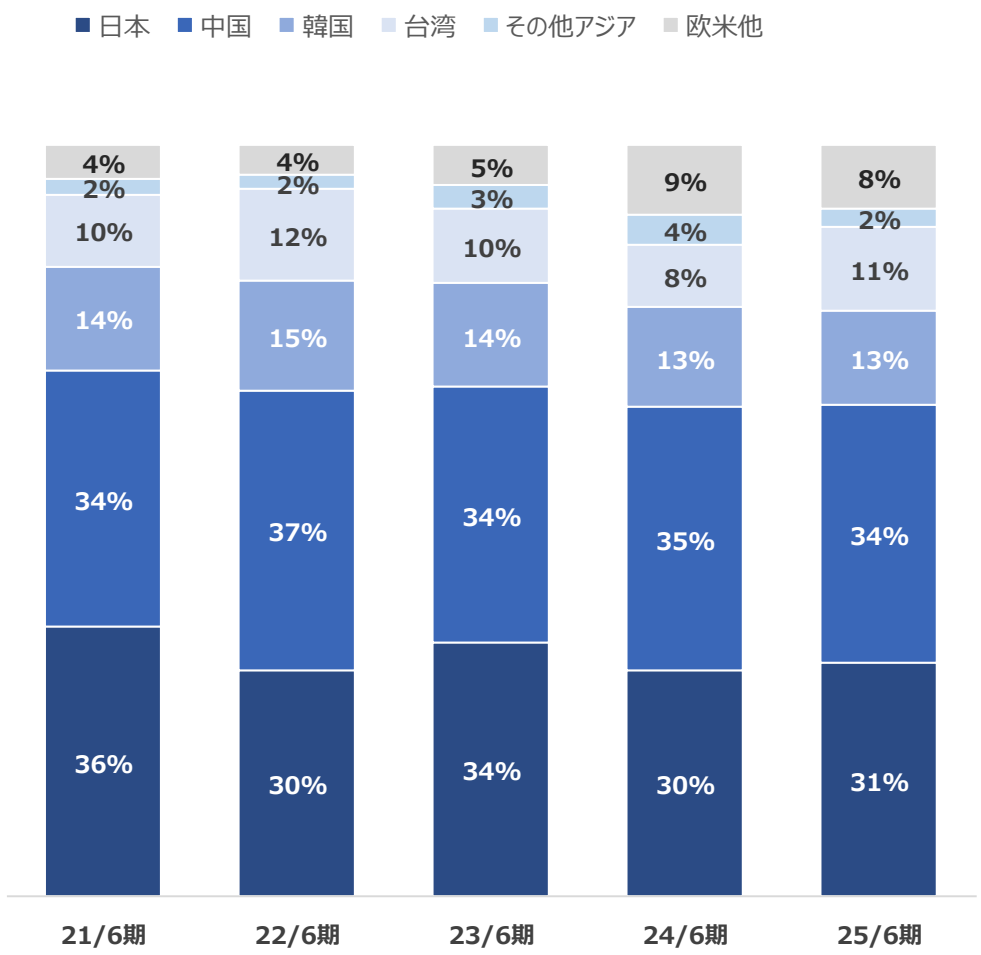
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

地域別売上高推移（実績）

売上高　【単位：億円】



売上高比率

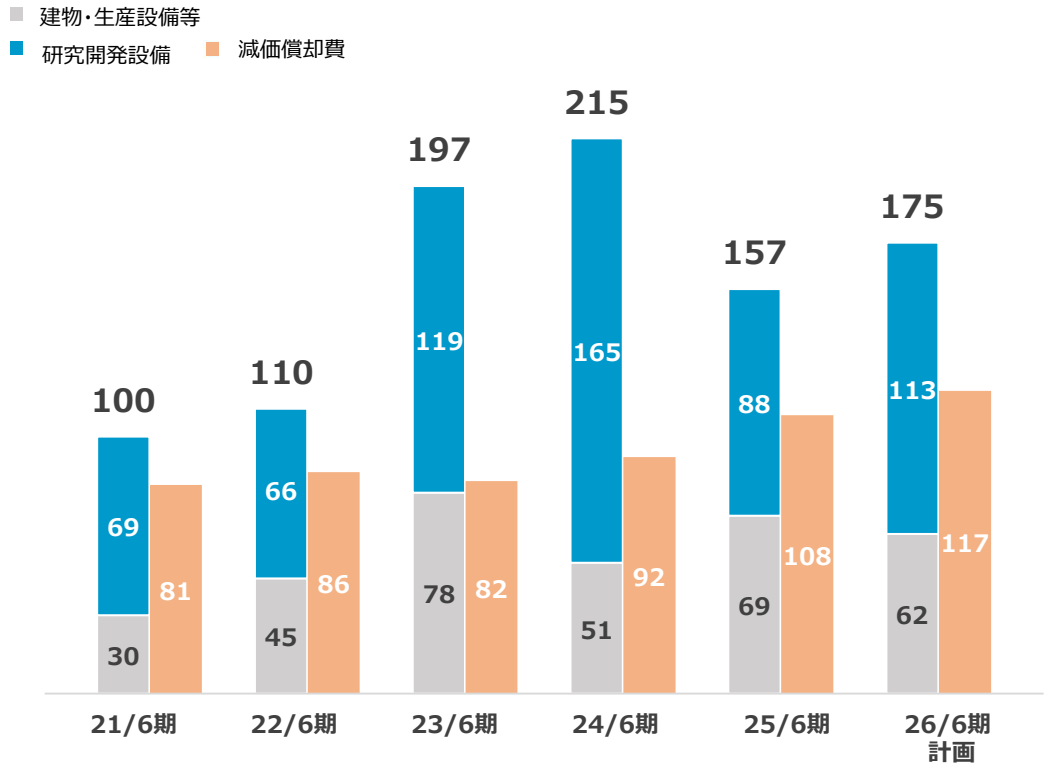


Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

設備投資･研究開発費の推移（実績･26年6月期計画）

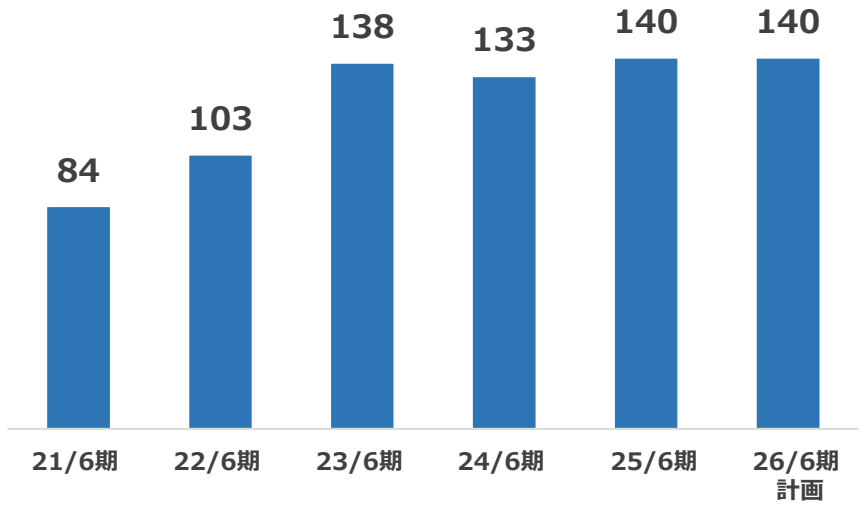
設備投資の推移･計画

【単位：億円】



研究開発費の推移･計画

【単位：億円】



※研究開発に関連する製造固定費含む

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

品目別内訳割合・営業利益率順位

品目別内訳割合

受注高	25/6期実績	26/6期計画
半導体電子	**704億円**	**910億円**
・メモリ	2割半ば	3割弱
・ロジック	2割半ば	2割弱
・電子部品	2割強	3割強
・パワー半導体	1割強	1割強
・実装	1割半ば	1割強
・その他	-	-
ディスプレイ・エネルギー	**465億円**	**400億円**
・LCD	3割弱	約2割
・OLED	7割弱	6割弱
・バッテリー	数%	約1割
・その他	数%	1割強

売上高	25/6期実績	26/6期計画
半導体電子	**893億円**	**1,005億円**
・メモリ	約2割	2割強
・ロジック	2割強	2割弱
・電子部品	2割半ば	3割半ば
・パワー半導体	2割半ば	1割強
・実装	約1割	約1割
・その他	-	-
ディスプレイ・エネルギー	**531億円**	**390億円**
・LCD	3割半ば	3割弱
・OLED	4割半ば	6割強
・バッテリー	1割半ば	1割弱
・その他	一桁半ば	数%

2025年6月期営業利益率順位

順位	品目
1	一般産業
2	コンポーネント
3	半導体電子
4	その他
5	材料
6	ディスプレイ・エネルギー関連

全社平均利益率は
4）その他と
5）材料との間

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

個別開示文書

マテリアル事業（ディスプレイ関連）

ULVAC

2025年8月13日

各　位

会　社　名　株式会社アルバック
代表者名　代表取締役社長 CEO　岩下　節生
（コード番号：6728 東証プライム）
問合せ先　経営企画室　佐藤　吉仁
（TEL. 0467-89-2022）

KFMIとのFPDターゲット事業の統合に向けた協議について

株式会社アルバック(代表取締役社長 CEO 岩下 節生、以下アルバック)は寧波江豊電子材料股份有限公司(以下KFMI)と連携し、両社のフラットパネルディスプレイ(以下FPD)のターゲット事業統合に向けて協議しております。
尚、この統合計画は現在調査・検討中であり、正式な契約はまだ締結されておりません。

◇本件の背景
アルバックは真空技術をコアに半導体・電子部品・FPD 向け製造装置や真空機器、材料を開発、提供しておりますが、本日発表の計画の通り、事業構造の最適化を行い、半導体・電子事業へのシフトを進めて参ります。
FPDの製造拠点は海外シフトが進んでいることもあり、今後FPDターゲット事業はKFMIと連携して展開することを検討して参ります。

以上

ポンプ用モータ事業（中国）

ULVAC

2025年8月13日

各　位

会　社　名　株式会社アルバック
代表者名　代表取締役社長 CEO　岩下　節生
（コード番号：6728 東証プライム）
問合せ先　管理本部IR部長　原田　大地
（TEL. 0467-89-2033）

愛発科天馬電機(靖江)有限公司の出資比率変更の件

首題の件、アルバックグループと江蘇上騏集団有限公司(以下、上騏)において持分譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。
同社は、当社グループで生産している真空ポンプ用モーターを安定的に供給しており、コンポーネント事業を強化していく上で重要な合弁先として位置づけております。上騏に一部持分譲渡することで、現地での生産・開発体制を更に強化し事業の成長を目指します。

◇持分比率

	現状	持分譲渡後
アルバックグループ	60%	40%
上騏	40%	60%

以上

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

用語集

- **PVD（Physical Vapor Deposition：物理成膜）**
  薄膜形成をする成膜技術（当社の場合は主にスパッタ）

- **POR（Process of Record）**
  量産に使われる認定プロセス

- **MHM（Metal Hard Mask：メタル・ハード・マスク）**
  配線層形成を目的に、エッチング工程での加工用マスク膜
  （当社はPVD：スパッタ膜）

- **HM（Hard Mask：ハード・マスク）**
  PVD等で成膜されたマスク層

- **FEOL（Front End of Line）**
  トランジスタやキャパシタ、抵抗などをシリコンウェハ上に形成する半導体製造プロセスの初期段階を指す

- **BEOL（Back End of Line）**
  FEOLで形成されたトランジスタなどのデバイスを接続するための配線や金属層を形成する半導体製造プロセスの後半工程を指す

- **GPU（Graphics Processing Unit：グラフィックス処理装置）**
  画像や映像の描画を高速に処理するために設計されたプロセッサ。AI推論では大量の加減乗除演算など、反復的な計算用に適する

- **HBM（High Bandwidth Memory：高帯域幅メモリ）**
  複数のDRAMを垂直に積層し、シリコン貫通電極（TSV）で接続することで、高速・高密度を実現した次世代メモリ技術

- **WLP（Wafer Level Package：ウェーハレベルパッケージ）**
  ウェーハ（半導体基板）の状態でパッケージング工程を行う技術で半導体パッケージング技術の一つ

- **PLP（Panel Level Package：パネルレベルパッケージ）**
  従来のウェハレベルパッケージ（WLP）に代わり、四角いパネル状の基板を用いてパッケージングを行う半導体パッケージング技術の一つ
  パネルに多数の半導体チップを基板全体に配置して一括してパッケージングする技術

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

ULVAC